

接着・封止材

Weekly Intelligence Report

2026-07-11 | 27件 | 10カ国

troy-technical.jp

今週のキーワード

先端PKGと環境材

半導体と持続可能性が接着材市場を牽引

27

件
記事数

10

カ国
対象国

31.2億

ドル
デシマブル市場

35.7

%
住ベ営業益増

今週の全27記事 — 5軸評価で読むべき記事を選ぶ

各列の見方 — 技術新規性：ブレイクスルー度合い 実用化距離：製品として使える近さ 市場インパクト：業界全体への影響規模
データ信頼性：定量データ・査読の有無 日本関連度：日本の企業・サプライチェーンとの直接的関連性

#	記事タイトル	種別	技術 新規性	実用化 距離	市場 インパクト	データ 信頼性	日本 関連度	一行サマリ
#01	ヘンケル軟包装提携	企業戦略						ヘンケルがApplied Adhesivesと独占販売提携し、米 国軟包装市場での接着剤・コーティング供給を強化。
#02	バイオ接着剤生産	新製品/技 術発表						BindEthicsがバイオベース・ホルムアルデヒドフリー 接着剤「Ecohesive」の工業規模生産を開始。EU規制 に対応し、建材・家具のリサイクル性を向上。
#03	Syensqo生産増強	企業戦略/ 生産能力 増強						Syensqoが米国工場を拡張し、航空宇宙向け構造用接 着剤の生産能力を30%以上増強。高成長市場の需要に 対応。
#04	UV接着剤新UL規制	規制/市場 動向						北米向けUV硬化型接着剤にUL 746E-2026が施行。5 00時間連続噴射後の硬化性能低下15%以下を義務付 け、製品開発・評価に影響。
#05	アルケマEV電池材	新製品/技 術発表						アルケマがEV・ESSバッテリー向けにLFPカソード用 PVDFバインダー新グレードとセラミックコートセパ レーター用アクリルバインダーを発表。全固体電池向 けも開発中。
#06	可逆接着UVコーティ ング	学術論文/ 技術ブレ ークスル ー						研究者らが基板シラン化と動的ジスルフィド化学を組 み合わせ、可逆接着性とリサイクル可能なUV硬化型コ ーティングを開発。多層包装のリサイクルを可能に。
#07	信越シリコン化粧品	新製品/製 品紹介						信越シリコンが低粘度油増粘シリコンクロスポリ マーなど、化粧品の官能性・質感向上に貢献する新原 料を発表。
#08	Dymax光学接着剤	新製品/製 品紹介						Dymaxが低収縮・高透明度を特徴とするUV硬化型光 学接着剤「OPシリーズ」を発表。光学ボンディングや レンズ組立向け。
#09	マレーシアHBMパッ ケージ	企業戦略/ 技術開発						マレーシアのコンソーシアムがHBM4向け先端パッ ケージングのパイロットライン開発に着手。NSW Automationが精密塗布装置を提供。
#10	AmkorパワーPKG	技術発表/ 業界イベ ント						Amkor TechnologyがSEMI Advanced Packaging S ummitでAI時代のパワーモジュールパッケージング技 術を発表。熱・電氣的課題、冷却アーキテクチャに焦 点。
#11	Amkorガラス基板評価	技術発表/ 研究成果						Amkor TechnologyがECTCでAI・HPC向けガラスコ ア基板の大型パッケージング性能評価を発表。優れた 電氣的特性と熱的安定性を強調。
#12	3M決算発表	企業財務/ 市場概観						3Mが2026年第2四半期決算発表を予定。産業、電子 、ヘルスケア市場での接着剤・テープを含む多様な製 品ポートフォリオを強調。

#	記事タイトル	種別	技術 新規性	実用化 距離	市場 インパクト	データ 信頼性	日本 関連度	一行サマリ
#13	コベストロHDI買収	企業戦略/ 生産能力 増強	●○○○ ○	●●●● ●	●●●○ ○	●●○○ ○	●●●○ ○	コベストロがタイと米国のHDI誘導体生産工場を買収し、グローバル生産能力を拡大。コーティング・接着剤産業への供給を強化。
#14	リサイクルプラ包装	新製品/企 業協業	●●●○ ○	●●●● ●	●●●● ○	●●●○ ○	●●●○ ○	LyondellBasellとMondelēzが協業し、75%リサイクルプラスチック由来のMarabouチョコレート包装を商業化。ケミカルリサイクルポリマーを使用。
#15	DELOバイオ接着剤	新製品/技 術発表	●●●○ ○	●●●● ○	●●●○ ○	●●○○ ○	●●●○ ○	DELOがバイオベース成分を主とした高性能多目的接着剤「PHOTOBOND SJ4192」を発表。多様な材料に強固な接着力を発揮。
#16	住友ベークライト戦略	企業戦略/ 市場動向	●●○○ ○	●●●● ●	●●●● ○	●●●○ ○	●●●● ●	住友ベークライトが2026年設備投資をアジア半導体封止材料製造拠点に集中。営業利益35.7%拡大で脱コモディティ化を加速。
#17	Indium TIMソリューション	技術発表/ 研究成果	●●●○ ○	●●○○ ○	●●●● ○	●●○○ ○	●●●○ ○	Indium CorporationがIMAPS ThermConでAI熱課題向けTIMソリューションを発表。金ベースの精密ダイアタッチブリフォームなど。
#18	H.B. Fuller再編	企業戦略/ 市場概観	●○○○ ○	●●●● ●	●●●○ ○	●●●○ ○	●●○○ ○	H.B. Fullerがポートフォリオ再編とフロアリング事業売却により高価値特殊接着剤市場に集中。売上高5.8%増と利益率向上を達成。
#19	TSMC先端PKG再編	業界動向/ 企業戦略	●●●● ○	●●●○ ○	●●●● ●	●●●○ ○	●●●● ●	TSMCが先端パッケージングへの投資を強化し、後工程工コシシステムの再編を主導。2.5D/3D集積、FOWLPなどが半導体競争環境を再構築。
#20	半導体反りマイクロCT	技術解説/ 応用技術	●●●○ ○	●●●● ○	●●●○ ○	●●●○ ○	●●●○ ○	半導体パッケージの反り問題に対し、マイクロCTが非破壊3D解析アプローチとして注目。CTEミスマッチや硬化収縮の可視化に貢献。
#21	ヘンケル決算発表	企業財務/ 市場概観	●○○○ ○	●●●● ●	●○○○ ○	●●○○ ○	●●○○ ○	ヘンケルが2026年第1四半期にオーガニック売上高成長1.7%を達成。接着技術部門が成長を牽引。
#23	デシマブル接着剤市場	市場予測/ 業界レポ ート	●○○○ ○	●●●● ●	●●●○ ○	●●●○ ○	●●●○ ○	デシマブル（分離可能）接着剤市場が2034年までに31.2億ドルに成長予測。リサイクル性、UV硬化型接着剤の採用が牽引。
#26	航空宇宙接着剤市場	市場予測/ 業界レポ ート	●○○○ ○	●●●● ●	●●●● ○	●●●○ ○	●●●○ ○	航空宇宙用接着剤・シーラント市場が2033年までに20.9億ドルに成長予測。航空機生産増加と軽量化需要が牽引。
#27	歯科用接着剤市場	市場予測/ 業界レポ ート	●○○○ ○	●●●● ●	●●○○ ○	●●●○ ○	●●○○ ○	歯科用接着剤・シーラント市場が2030年までに104.4億ドルに成長予測。ユニバーサル接着剤や生体活性シーラントが牽引。
#28	先端PKG材料分析	業界レポ ート/技術 分析	●●●○ ○	●●○○ ○	●●●● ●	●●●○ ○	●●●● ●	IDTechExが2.5D/3D Cu-Cuハイブリッドボンディング材料、EMC、MUF、ガラスパネルベースなど先端半導体パッケージング材料の技術動向を分析。
#29	インスタント接着剤市場	市場予測/ 業界レポ ート	●○○○ ○	●●●● ●	●●●○ ○	●●●○ ○	●●●○ ○	インスタント接着剤市場が2033年までに46.2億ドルに成長予測。エレクトロニクス、EV、医療機器製造が牽引。
#30	アンダーフィル市場成長	市場予測/ 技術動向	●●○○ ○	●●●○ ○	●●●● ○	●●●○ ○	●●●● ○	電子回路基板アンダーフィル市場が先進半導体パッケージング需要で成長予測。ナノフィラー組み込みや低粘度化が進む。

●●●●○ High ●●●○ Med-High ●●○○ Med ●○○○ Low | 背景黄色 = 注目記事

今週、判断に影響しうる3つの問い

①あなたの会社の製品は、北米の新規制UL 746E-2026に対応できていますか？

北米市場向けUV硬化型接着剤に新たなUL 746E-2026規制が施行されました。500時間の連続噴射後も硬化性能の低下が15%を超えないことが義務付けられ、高精度アプリケーションにおける長期信頼性が問われます。既存製品の適合性確認と、未対応の場合の製品開発・評価戦略の見直しは急務です。

②TSMC主導の先端パッケージングエコシステム再編は、自社のサプライチェーンにどのような影響を与えますか？

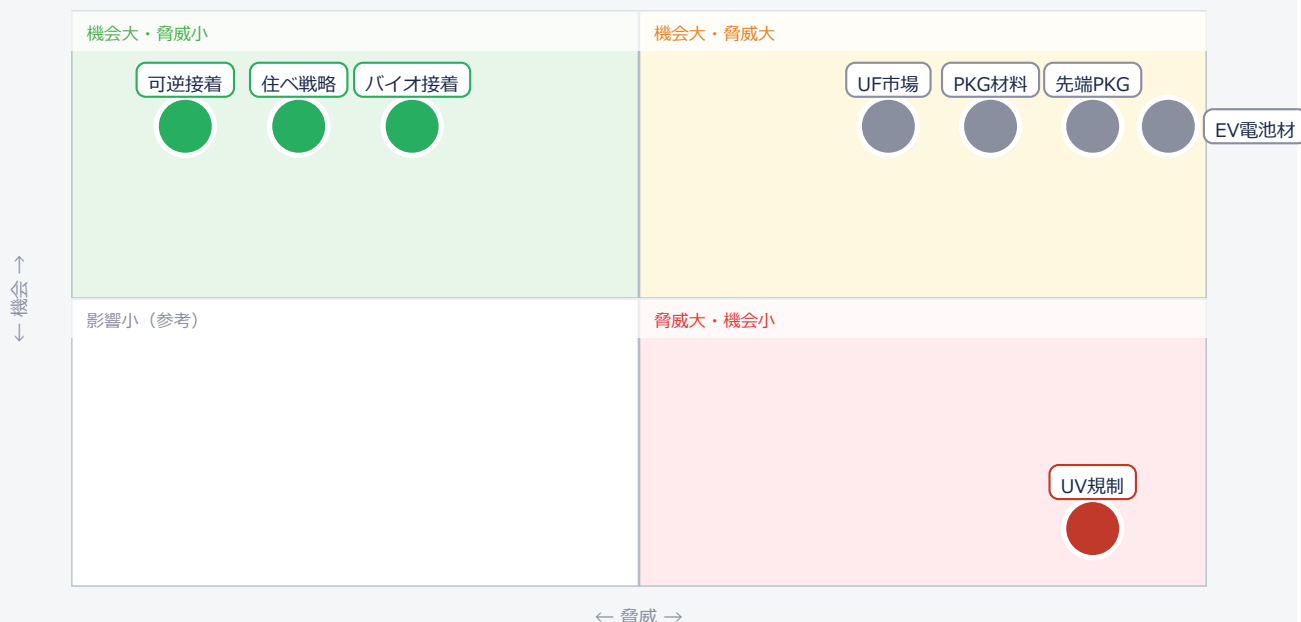
TSMCが2.5D/3D集積やFOWLPといった先端パッケージング技術への投資を強化し、後工程エコシステムの再編を加速しています。これは半導体材料・装置メーカーにとって大きなビジネスチャンスであると同時に、技術競争の激化とサプライチェーン構造の変化を意味します。自社の材料や装置がこの新たなエコシステムでどのような位置づけになるか、戦略的な評価が必要です。

③多層包装のリサイクルを可能にする「可逆接着剤」は、自社の持続可能性戦略を変革する可能性を秘めているか？

研究段階ながら、可逆接着性とリサイクル可能なUV硬化型コーティングが開発されました。これは多層包装材のリサイクル困難という長年の課題を解決し、循環型経済への移行を加速する画期的な技術です。包装材メーカーや接着剤メーカーは、この技術が将来的に市場に与えるインパクトを評価し、自社のR&D戦略や製品ポートフォリオにどう組み込むかを検討すべきです。

日本企業にとっての「機会 vs 脅威」

日本企業にとっての「機会 vs 脅威」マトリクス



項目	象限	↑ 機会	↓ 脅威
● 可逆接着	機会大	多層包装リサイクル	—
● 先端PKG	注意	材料・装置需要増	技術競争激化
● UV規制	脅威大	—	北米市場参入障壁

● 住ベ戦略	機会大	高付加価値化	—
● バイオ接着	機会大	環境対応製品	—
● EV電池材	注意	EV電池材料需要	競争激化・技術変化
● PKG材料	注意	次世代材料開発	材料開発競争
● UF市場	注意	ナノフィラー応用	微細化対応課題

深掘り ① — 多層包装リサイクルを可能にする可逆接着UVコーティング

#06 | 2026/07/09 | European Coatings | 技術新規性●●●●● 実用化距離●○○○○ 市場インパクト●●●●●
データ信頼性●●●●● 日本関連度●●●●●

研究者らは、基板シラン化と動的ジスルフィド化学を組み合わせることで、可逆的な接着性を有するUV硬化型コーティングを開発しました。このシステムは光開始剤フリーであり、強力な接着力とオンデマンドでの剥離性を両立させます。多層包装などのリサイクル困難な複合材料のリサイクルを可能にし、持続可能なパッケージングソリューションに新たな可能性を開く画期的な技術です。

ジスルフィド結合の動的な性質を利用し、特定の刺激で剥離・再形成が可能。光開始剤フリーにより、環境負荷と毒性問題を回避します。これにより、多層フィルムの各層を容易に分離し、高品質な素材リサイクルを実現。循環型経済への貢献が期待されます。

▶ シニアテクニカルアナリスト

【数値の妥当性評価】本研究は学術的なブレークスルーであり、具体的な製品スペックの数値はまだ提示されていませんが、原理的な実現可能性は高いと評価できます。ジスルフィド結合の可逆性をUV硬化システムに応用した点は非常に興味深く、多層材リサイクルの根本的な課題解決に繋がる可能性を秘めています。【実用化に向けた未解決課題】基礎研究段階であり、実用化には多くの課題が残ります。特に、剥離条件の汎用性（熱、化学物質など）、接着・剥離サイクル寿命、量産性、コスト、そして食品接触用途における安全性評価などが挙げられます。また、既存のリサイクルインフラとの適合性も重要です。【日本企業にとっての機会と脅威】【機会】日本の包装材メーカーや接着剤メーカーは、この技術を早期にキャッチアップし、共同研究やライセンス取得を通じて、次世代の環境配慮型包装材市場でのリーダーシップを確立するチャンスがあります。特に、リサイクル困難な複合材を多く扱う企業にとっては、新たな高付加価値製品開発の道が開かれます。【脅威】この技術が海外で先行して商業化された場合、日本の包装材産業は競争力を失う可能性があります。また、環境規制の強化が加速する中で、既存の多層包装材が市場から淘汰されるリスクも考えられます。【具体的な次のアクション】【R&D;】この技術の基礎研究動向を継続的にモニタリングし、大学や研究機関との連携を模索する。特に、剥離メカニズムの制御性、材料の耐久性、コスト効率に関する研究に注目する。【経営企画】中長期的な包装材市場のトレンドとして、リサイクル性向上技術の重要性を再評価し、自社のサステナビリティ戦略に組み込むためのロードマップを検討する。

深掘り ② — TSMC主導の先端パッケージング再編が半導体競争環境を再構築

#19 | 2026/07/09 | The Economy | 技術新規性●●●●○ 実用化距離●●●○○ 市場インパクト●●●●●
データ信頼性●●●○○ 日本関連度●●●●●

TSMCが先端パッケージング技術への投資を強化し、半導体後工程エコシステムの再編を主導しています。2.5D/3D集積、FOWLP、SiPといった技術が、従来のプロセス微細化の限界を補完し、AIやHPC向け半導体の性能向上を牽引。これにより、半導体設計と製造の境界線が曖昧になり、新たな価値創造の機会が生まれています。

CoWoSやInFOなどのTSMC技術は、インターポーザやRDLを通じてチップ間の接続密度と効率を最大化します。このプロセスでは、精密なダイアタッチ、アンダーフィル、モールド材料、熱界面材料（TIM）が不可欠であり、パッケージ全体の性能と信頼性を決定します。日本の材料・装置メーカーにとっては、これらの高機能材料と精密製造装置の需要増が見込まれます。

▶ シニアテクニカルアナリスト

【数値の妥当性評価】記事は市場動向と企業戦略の概観であり、具体的な数値データは少ないですが、TSMCの業界における影響力と先端パッケージングへの投資の規模を考慮すると、その戦略的意義は非常に大きいと評価できます。エコシステム再編という表現も、業界の構造変化を的確に捉えています。

【実用化に向けた未解決課題】先端パッケージング技術は急速に進化していますが、材料の熱膨張係数（CTE）ミスマッチによる応力、微細化に伴う接続信頼性の確保、そしてコスト削減が依然として大きな課題です。特に3D積層では、熱管理と歩留まりの向上が継続的なR&Dテーマとなります。

【日本企業にとっての機会と脅威】 【機会】日本の材料メーカーは、高機能な接着剤、封止材、熱界面材料、基板材料などで世界をリードしており、TSMCのエコシステム再編は、これらの先端材料の需要をさらに押し上げる大きなビジネスチャンスです。また、精密製造装置メーカーも、新たなパッケージングプロセスに対応する装置開発で貢献できます。 【脅威】TSMCが主導するエコシステムに迅速に適応できない企業は、サプライチェーンから取り残されるリスクがあります。特に、材料や装置の仕様がTSMCの要求に合致しない場合、市場シェアを失う可能性があります。また、台湾や韓国企業との技術競争も激化するでしょう。 【具体的な次のアクション】 【半導体PKG】TSMCの技術ロードマップ（特に材料・プロセス要件）を詳細に分析し、自社製品との適合性を評価する。必要に応じて、共同開発や技術提携を検討する。 【R&D;】2.5D/3Dパッケージング向けの高熱伝導性・低CTE材料、低応力封止材、高信頼性ダイアタッチ材料の開発を加速する。 【経営企画】先端パッケージング市場における自社の競争優位性を再評価し、M&Aや戦略的投資の機会を検討する。

深掘り ③ — 北米向けUV硬化型接着剤に新UL 746E-2026規制が施行

#04 | 2026/07/05 | Industry Compliance Update | 技術新規性●●●○○ 実用化距離●●●●● 市場インパクト●●●●○
データ信頼性●●●○○ 日本関連度●●●●○

2026年7月1日より、北米市場向けUV硬化型接着剤に対し、UL 746E-2026が義務化されました。この新規制は、連続ピエゾジェットバルブ操作で使用するUV接着剤について、500時間の連続噴射後も硬化性能の低下が15%を超えないことを第三者検証機関によって示すことを必須としています。これは、高精度アプリケーションにおけるUV接着剤の長期信頼性と性能を保証することを目的としています。

この規制導入は、北米市場向けの製品開発、材料選定、生産ラインの受け入れ、および技術合意に直接的な影響を与えます。特にエレクトロニクス製造や医療機器組み立てなど、精密かつ信頼性の高い接着が不可欠な分野で重要です。接着剤メーカーは、より安定した硬化性能を持つ新処方の開発と品質管理プロセスの見直しが求められます。

▶ シニアテクニカルアナリスト

【数値の妥当性評価】「500時間連続噴射後も硬化性能低下15%以下」という具体的な数値基準は、UV接着剤の長期信頼性を客観的に評価する上で非常に明確であり、妥当な要求レベルと考えられます。特に高精度なディスペンスが求められるアプリケーションでは、初期性能だけでなく、プロセス中の安定性が製品品質に直結するため、この規制は業界全体の品質向上に寄与するでしょう。【実用化に向けた未解決課題】既存のUV接着剤の中には、この新規制に適合しないものも出てくる可能性があります。特に、長期的なUV照射や熱履歴による材料劣化メカニズムの解明と、それらを抑制する新しいモノマーや添加剤の開発が課題となります。また、第三者検証機関による認証プロセスにかかる時間とコストも考慮する必要があります。【日本企業にとっての機会と脅威】【機会】日本の接着剤メーカーは、高品質・高信頼性のUV接着剤開発に強みを持つ企業が多く、この新規制は、その技術力を北米市場でアピールする絶好の機会となります。規制適合製品をいち早く提供することで、市場シェア拡大に繋がる可能性があります。

【脅威】北米市場に製品を供給している、または供給を計画している日本企業は、既存製品のUL 746E-2026適合性を速やかに確認する必要があります。未対応の場合、市場からの撤退や大規模な製品改修が必要となり、ビジネス機会の損失やコスト増大のリスクがあります。特に、中小企業にとっては大きな負担となるでしょう。【具体的な次のアクション】

【R&D;】既存のUV接着剤ポートフォリオについて、UL 746E-2026の試験基準に準拠した評価を速やかに実施する。必要に応じて、性能向上に向けた処方改良に着手する。【営業・マーケティング】北米市場の顧客に対し、新規制への対応状況を明確に伝え、適合製品のプロモーションを強化する。

【調達】北米市場向け製品に使用するUV接着剤について、サプライヤーのUL 746E-2026適合状況を確認し、必要に応じて代替品の評価を開始する。

その他の注目記事

LyondellBasellとMondelēz、75%リサイクルプラスチック由来のMarabouチョコレート包装を商業化 (LyondellBasell - Investors)

技術新規性●●●○○ 実用化距離●●●●● 市場インパクト●●●●○

ケミカルリサイクルポリマーを食品包装に商業化。日本の食品包装材メーカーは、この技術がサプライチェーンに与える影響を注視すべき。

Amkor Technology、ECTC 2026でAI・HPC向けガラスコア基板の大型パッケージング性能評価を発表 (Amkor Technology)

技術新規性●●●○○ 実用化距離●●○○○ 市場インパクト●●●●○

ガラスコア基板は次世代AI・HPCパッケージングの鍵。日本の基板材料メーカーは、Amkorの評価結果を参考にR&D;戦略を検討すべき。

ベルギーのSyensqo、航空宇宙向け構造用接着剤生産能力を30%以上増強するため米国工場を拡張 (Industrial Equipment News)

技術新規性●●○○○ 実用化距離●●●●● 市場インパクト●●●●○

航空宇宙・防衛・自動車分野での高性能接着剤需要の高まりを示す。日本の部品メーカーは、サプライヤーの供給安定性を確認すべき。

半導体パッケージの反り問題にマイクロCTが有効な非破壊3D解析アプローチとして注目 (AZoM)

技術新規性●●●○○ 実用化距離●●●●○ 市場インパクト●●●○○

半導体パッケージの反り解析にマイクロCTが有効。日本の半導体メーカーや材料メーカーは、品質管理・R&Dにおける解析技術の導入を検討すべき。

今週のアクション提案

記事評価マトリクスと機会/脅威分析を踏まえたアクション提案です。

■ 即時（今週中）

- 【R&D;/品質保証】北米市場向けUV硬化型接着剤のUL 746E-2026適合性について、自社製品およびサプライヤー製品の現状を緊急で確認し、未適合の場合は対応計画を策定する。
- 【調達】主要な接着剤・封止材サプライヤーに対し、UL 746E-2026への対応状況、および先端半導体パッケージング材料のロードマップについて情報提供を要請する。

■ 短期（1ヶ月）

- 【R&D;/半導体PKG】TSMC主導の先端パッケージングエコシステム再編に関する技術動向（#19, #28, #30）を深掘りし、自社の材料・装置技術が貢献できる領域を特定する。
- 【経営企画/R&D;】可逆接着剤（#06）やバイオベース接着剤（#02）など、持続可能性に貢献する新技術の動向を調査し、中長期的なR&D;テーマとしての可能性を評価する。
- 【EV設計/電池材料】アルケマのEV・ESSバッテリー向けバインダー（#05）について、技術詳細を入手し、自社のバッテリー設計や材料選定への適用可能性を検討する。

■ 中長期（四半期～）

- 【経営企画/R&D;】先端パッケージング材料（ガラスコア基板、アンダーフィル等）の技術開発ロードマップを策定し、日本の強みである材料技術を活かした競争戦略を構築する。
- 【R&D;】多層包装のリサイクル性向上に向けた可逆接着技術の基礎研究、または関連するオープンイノベーションプログラムへの参加を検討する。
- 【調達/サプライチェーン】グローバルな接着剤・封止材市場の再編（#01, #03, #13, #18）を継続的にモニタリングし、サプライチェーンの安定性確保とリスク分散戦略を強化する。

接着・封止材 採用記事全文集

出力日: 2026-07-11

採用記事数: 27 件

収録記事一覧

- #01 ヘンケルとApplied Adhesives、米国の軟包装市場で独占的販売提携を締結
- #02 BindEthics、工業規模のバイオベース・ホルムアルデヒドフリー接着剤「Ecohesive」生産を開始
- #03 ベルギーのSyensqo、航空宇宙向け構造用接着剤生産能力を30%以上増強するため米国工場を拡張
- #04 北米向けUV硬化型接着剤に新UL 746E-2026規制が施行、連続噴射後も硬化性能15%低下以下を義務付け
- #05 アルケマ、Battery Show Europe 2026でEV・ESSバッテリー向けPVDFとアクリルバインダーを発表
- #06 研究者らが可逆接着性とリサイクル可能なUV硬化型コーティングを開発：多層包装に新境地
- #07 信越シリコン、低粘度油増粘シリコンクロスポリマーなど革新的化粧品原料を発表
- #08 Dymax、光学ボンディングおよびレンズ組立向けに低収縮・高透明度のUV硬化型光学接着剤「OPシリーズ」を発表
- #09 マレーシアのコンソーシアム、高帯域幅メモリ（HBM）向け先端パッケージングのパイロットライン開発に着手
- #10 Amkor Technology、SEMI Advanced Packaging Summit 2026でAI時代におけるパワーモジュールパッケージング技術を発表
- #11 Amkor Technology、ECTC 2026でAI・HPC向けガラスコア基板の大型パッケージング性能評価を発表
- #12 3Mが2026年第2四半期決算発表を7月21日に予定、産業・電子・ヘルスケア市場での多様な製品ポートフォリオを強調
- #13 コベストロ、HDI誘導体生産工場をタイと米国で買収しグローバル生産能力を拡大
- #14 LyondellBasellとMondelezが協業し、75%リサイクルプラスチック由来のMarabouチョコレート包装を商業化
- #15 DELO、バイオベース成分を主とした高性能多目的接着剤「PHOTOBOND SJ4192」を発表
- #16 住友ベークライト、2026年設備投資をアジア製造拠点に再編し、営業利益35.7%拡大で脱コモディティ化を加速
- #17 Indium Corporation専門家がIMAPS ThermConでAI熱課題向けTIMソリューションを発表
- #18 H.B. Fuller、ポートフォリオ再編とフロアリング事業売却により高価値市場を優先し、売上高5.8%増と利益率向上を達成

#19 TSMCがリードする後工程エコシステム再編加速、先端パッケージングが半導体競争環境を再構築

#20 半導体パッケージの反り問題にマイクロCTが有効な非破壊3D解析アプローチとして注目

#21 ヘンケル、2026年第1四半期に好調なオーガニック売上高成長1.7%を達成、接着技術部門が牽引

#23 Strategic Packaging Insights、デシマブル接着剤市場が2034年までに31億2,000万ドルに成長と予測

#26 オープンPR、航空宇宙用接着剤・シーラント市場が2033年までに20億9,000万ドルに急成長と予測

#27 オープンPR、歯科用接着剤・シーラント市場が2030年までに104億4,000万ドルに達すると予測

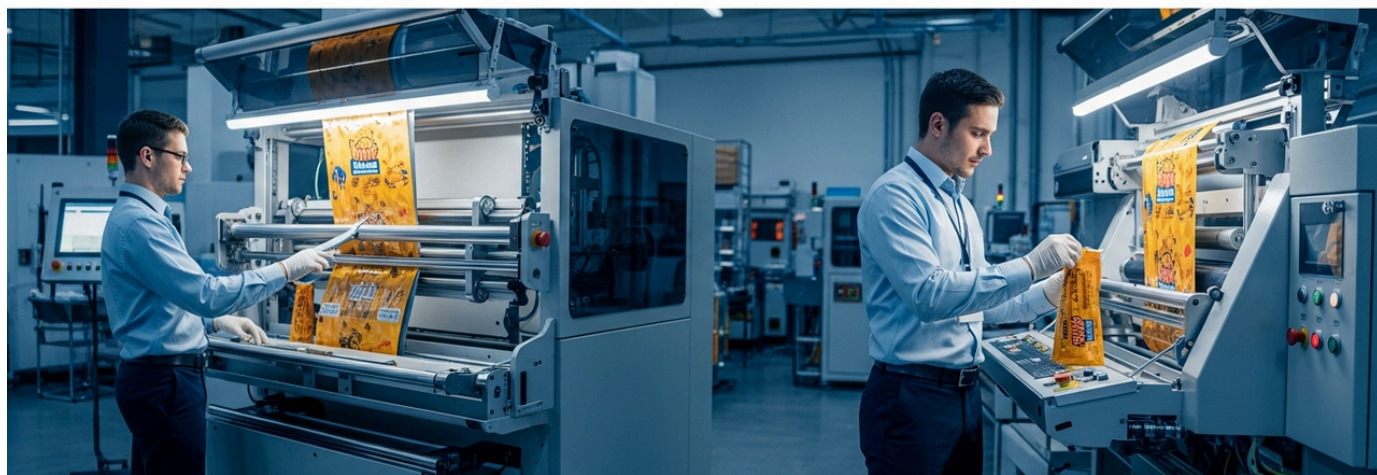
#28 IDTechEx、2.5D/3D Cu-Cuハイブリッドボンディング材料など先端半導体パッケージングの未来を形作る材料を分析

#29 オープンPR、インスタント接着剤市場が2033年までに46億2,000万ドルに成長と予測

#30 Data Insights Reports、電子回路基板アンダーフィル市場が先進半導体パッケージング需要で成長と予測

#01 ヘンケルとApplied Adhesives、米国の軟包装市場で独占的販売提携を締結

公開日 2026年07月08日 PR Newswire アメリカ



概要

ヘンケル・アドヒーズ・テクノロジーズは、Applied Adhesivesとの独占的販売提携を発表し、米国における軟包装市場での事業を拡大します。この提携により、ヘンケルの革新的な接着剤およびコーティング技術が、Applied Adhesivesの広範な販売網と技術サービスを通じて米国内のコンバーターに提供されます。初期段階では、食品・飲料、健康・美容、ペット製品といった主要な軟包装用途に注力し、顧客へのアクセスとサポートを強化します。この動きは、ヘンケルが世界的なリーダーシップを維持し、地域市場での成長を加速させるための戦略的な一歩です。

詳細

主要成果

ヘンケル・アドヒーズブ・テクノロジーズは、米国における軟包装市場でのプレゼンスを大幅に強化するため、Applied Adhesivesとの間で独占的な販売提携を締結しました。この戦略的パートナーシップにより、ヘンケルの最先端の接着剤およびコーティングソリューションが、Applied Adhesivesの堅牢な販売網、高度な技術サービス、効率的な在庫管理、および確立された物流ネットワークを通じて、米国全土のコンバーターへ供給されます。

技術・臨床詳細

この提携は、特に食品・飲料、健康・美容、ペット製品といった需要の高い軟包装分野に焦点を当てています。ヘンケルは、これらの分野で必要とされる高い性能基準、安全性、および持続可能性要件を満たす幅広い接着剤およびコーティング技術を提供します。Applied Adhesivesは、その地域の専門知識と顧客密着型のサービスにより、これらの製品の効果的な導入と技術サポートを保証します。この統合されたアプローチにより、最終製品の品質向上、生産効率の最適化、および市場投入期間の短縮が期待されます。

背景・業界文脈

軟包装市場は、消費者の利便性、製品保護、および持続可能性への要求の高まりにより、継続的な成長を遂げています。接着剤およびコーティング技術は、多層フィルムの接着強度、バリア性、およびリサイクル可能性において中心的な役割を担っています。この提携は、ヘンケルのグローバルな研究開発能力とApplied Adhesivesのローカル市場への深い理解を組み合わせることで、進化する市場のニーズに対応し、顧客に最適なソリューションを提供することを目指しています。

今後の展望

今回の提携は、ヘンケルの接着技術部門が北米市場における市場シェアを拡大し、収益成長を加速させる重要な機会を提供します。Applied Adhesivesにとっては、製品ポートフォリオを強化し、顧客への提供価値を高めることで、競争優位性を確立する基盤となります。両社は、協力体制を通じて、革新的な軟包装ソリューションの開発と普及をさらに推進し、持続可能な包装産業の発展に貢献することが期待されます。

元記事: <https://www.prnewswire.com/news-releases/applied-adhesives-named-exclusive-us-distributor-for-henkel-flexible-packaging-technologies-302819822.html>

収集日: 2026年07月10日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#02 BindEthics、工業規模のバイオベース・ホルムアルデヒドフリー接着剤「Ecohesive」生産を開始

公開日 2026年07月06日 Packaging Europe イギリス



概要

英国のBindEthics社は、同社の画期的なバイオベース・ホルムアルデヒドフリー接着剤「Ecohesive™」の工業規模生産への移行を開始しました。この接着剤は、建築および家具のサプライチェーンにおける有害なホルムアルデヒド系樹脂を排除し、設計された木材製品のリサイクル可能性を高めることを目的としています。バッチ生産規模を40リットルから2,000リットルへと大幅に拡大することで、同社は2026年8月6日に施行されるEU REACH規制の強化に対応し、持続可能な建築材料市場での需要に応えます。これは、持続可能性と高性能を両立させる接着技術の重要なブレイクスルーを示しています。

詳細

主要成果

BindEthics社は、革新的なバイオベースのホルムアルデヒドフリー接着剤「Ecohesive™」の工業規模生産を成功裏に開始しました。この画期的な接着剤は、建築および家具の製造プロセスから有害なホルムアルデヒド系樹脂を完全に排除し、同時に設計された木材製品の全体的なリサイクル可能性と循環性を大幅に向上させます。初期の40リットルバッチから2,000リットル規模の生産への拡大は、持続可能な接着ソリューションへの高まる需要に対応するための重要なマイルストーンとなります。

技術・臨床詳細

Ecohesive™は、化石燃料や石油化学原料に依存しないバイオベースの原料から開発された高性能構造接着剤です。同社の技術は、従来の工業用混合・プレス設備との「ドロップイン」互換性を持つように設計されており、製造業者が既存のインフラを大幅に変更することなく、容易に採用できる点が特徴です。この接着剤は、強力な接着性能を維持しつつ、ホルムアルデヒドの健康リスクを排除することで、作業環境の安全性と製品の環境負荷低減に貢献します。

背景・業界文脈

接着剤業界は、環境規制の強化と消費者の持続可能性意識の高まりにより、大幅な変革期を迎えています。特に、EUのREACH規制によるホルムアルデヒド排出基準の厳格化（2026年8月6日施行）は、製造業者に対し、代替ソリューションへの移行を促しています。英国のパーティクルボード部門だけでも年間3億8,800万ポンド相当の尿素ホルムアルデヒド接着剤を消費しており、Ecohesive™のような代替品は、市場に大きな影響を与える可能性を秘めています。

今後の展望

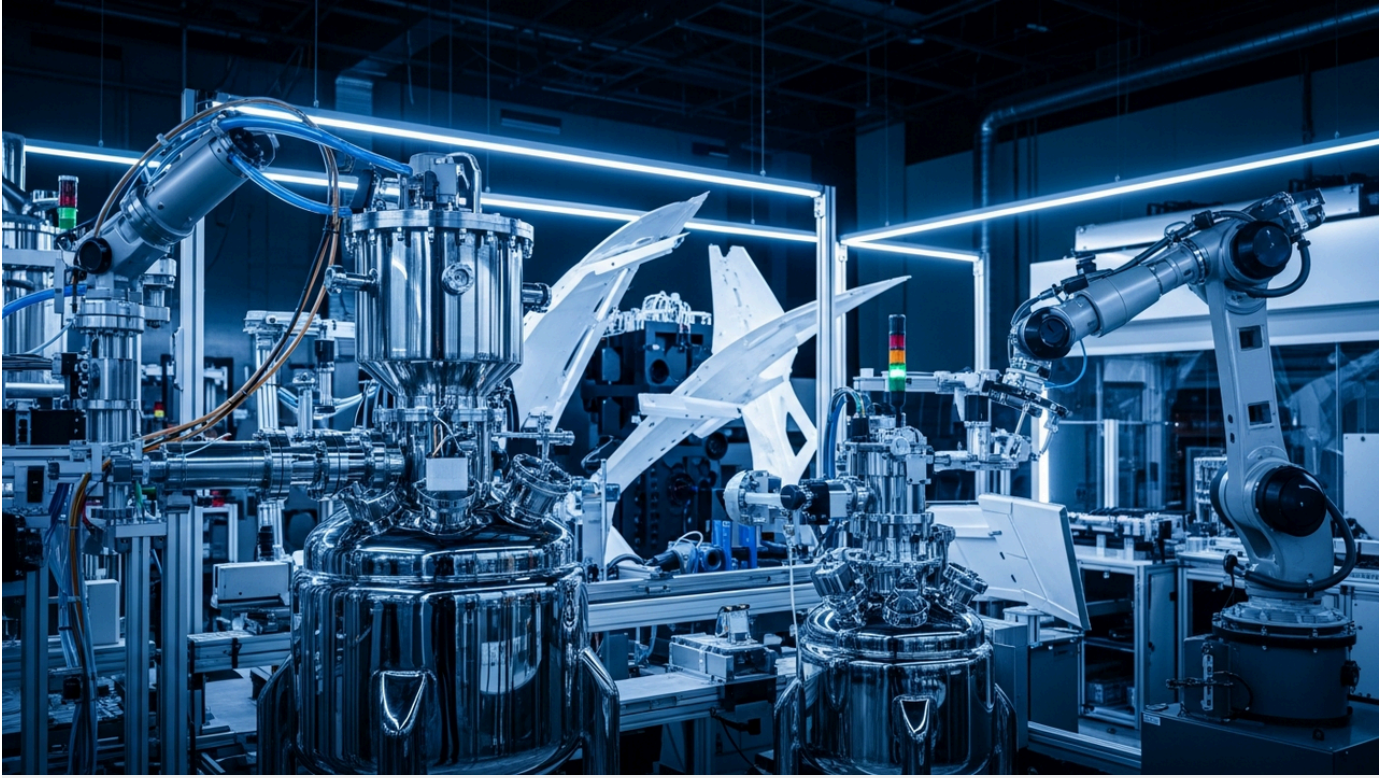
BindEthics社の工業規模生産への移行は、持続可能な建築材料市場における同社の地位を確立するものです。高性能かつ環境に優しい接着剤の提供は、木材加工、家具製造、およびその他の産業において、サプライチェーン全体の脱炭素化と循環経済への移行を加速させることが期待されます。2026年内の顧客試験の開始と市場への本格導入を通じて、Ecohesive™は業界の新たな標準を確立し、より健康的で持続可能な製品の普及に貢献するでしょう。

元記事: <https://packagingeurope.com/news/bio-based-adhesive-from-bindethics-begins-industrial-scale-production/14468.article>

収集日: 2026年07月10日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#03 ベルギーのSyensqo、航空宇宙向け構造用接着剤生産能力を30%以上増強するため米国工場を拡張

公開日 2026年07月09日 Industrial Equipment News アメリカ



概要

ベルギーの化学メーカーSyensqoは、米国メリーランド州ハバディグレイスの製造拠点拡張工事に着工しました。この数百万ドル規模の投資により、主に航空宇宙市場向けの先進的な構造用接着剤、接合材、プライマー材料の生産能力が30%以上増加します。この拡張は、航空宇宙、防衛、自動車分野におけるサプライチェーンの信頼性を高め、顧客需要の増加に迅速に対応することを目的としています。Syensqoは、戦略的な製造能力の強化を通じて、高成長市場でのリーダーシップを確固たるものにする方針です。

主要成果

ベルギーの化学メーカーであるSyensqoは、米国メリーランド州ハバディグレイスに位置する主要製造拠点の拡張工事に着工しました。この多額の投資により、同社は航空宇宙産業向けに特化した先進的な構造用接着剤、接合材、およびプライマー材料の生産能力を30%以上向上させることを目指しています。この戦略的な拡張は、高まるグローバルな需要に迅速かつ確実に供給対応するためのSyensqoのコミットメントを明確に示すものです。

技術・臨床詳細

今回の拡張は、特に航空宇宙、防衛、および自動車といった要求の厳しい市場向けに設計された高性能材料の生産に重点を置いています。Syensqoが生産する構造用接着剤は、極限環境下での優れた強度、耐久性、軽量化特性を提供し、次世代航空機や自動車の設計において不可欠な要素となります。生産能力の増強は、これらの先進材料が、増え続ける顧客の需要を満たすために必要な規模で製造されることを保証します。

背景・業界文脈

航空宇宙および防衛産業では、燃料効率の向上と性能向上のため、複合材料の使用と軽量化設計が加速しており、これに伴い、高性能接着剤およびシーラントの需要が飛躍的に高まっています。また、自動車産業、特に電気自動車（EV）分野においても、車体軽量化とバッテリーコンポーネントの構造接着において、同様の材料が不可欠となっています。Syensqoのこの投資は、これらの重要産業における供給信頼性を強化し、戦略的パートナーとしての地位を確立するものです。

今後の展望

今回の米国工場拡張は、Syensqoが革新的な材料ソリューションを通じて、高成長市場セグメントでリーダーシップを拡大するための長期戦略の一環です。生産能力の向上は、顧客が最先端のプロジェクトを進める上で不可欠な材料を確保できるよう支援し、同社の市場競争力をさらに高めます。この投資は、Syensqoが世界的なサプライチェーンの強靱化に貢献し、次世代の航空宇宙および自動車技術の発展を支える役割を果たすことを示しています。

元記事: <https://www.ien.com/operations/news/22970250/belgian-adhesive-maker-breaks-ground-on-us-expansion>

収集日: 2026年07月10日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#04 北米向けUV硬化型接着剤に新UL 746E-2026規制が施行、連続噴射後も硬化性能15%低下以下を義務付け

公開日 2026年07月05日 Industry Compliance Update アメリカ



概要

2026年7月1日より、北米市場向けUV硬化型接着剤に対し、UL 746E-2026が義務化されました。この新規制は、連続ピエゾジェットバルブ操作で使用するUV接着剤について、500時間の連続噴射後も硬化性能の低下が15%を超えないことを第三者検証機関によって示すことを必須としています。これにより、北米市場向けの製品開発、材料選定、生産ラインの受け入れ、および技術合意に直接的な影響が生じます。規制導入は、高精度アプリケーションにおけるUV接着剤の長期信頼性と性能を保証することを目的としています。

詳細

主要成果

北米市場向けのUV硬化型接着剤に対して、2026年7月1日より新たな規制基準UL 746E-2026が義務化されました。この新要件により、連続ピエゾジェットバルブ操作で利用されるUV接着剤は、500時間の連続噴射テスト後もその硬化性能の低下が15%を超えないことを独立した第三者検証機関によって証明することが必須となります。この基準は、特に高精度かつ高速な生産ラインで要求されるUV接着剤の安定性と信頼性を確保するためのものです。

技術・臨床詳細

UL 746E-2026の導入は、UV硬化型接着剤の性能評価に新たな厳格な基準をもたらします。従来、接着剤の初期性能は評価されていましたが、連続的なディスペンスと硬化サイクルを経た後の長期安定性、特に硬化速度や接着強度の維持は、これまで十分に標準化されていませんでした。500時間という長時間の連続噴射試験は、接着剤が実際の生産環境下で繰り返し使用された際の性能劣化挙動を正確にシミュレートし、その耐久性を客観的に評価するものです。この要件は、エレクトロニクス製造や医療機器組み立てなど、精密かつ信頼性の高い接着が不可欠な分野で特に重要となります。

背景・業界文脈

UV硬化型接着剤は、その高速硬化性、精密な塗布能力、および溶剤フリーであることから、電子機器、医療機器、光学部品などの製造において広く採用されています。しかし、特に微細化が進むコンポーネントの製造プロセスでは、接着剤のわずかな性能変動でも製品の品質や信頼性に重大な影響を及ぼす可能性があります。今回のUL規制の強化は、これらの高付加価値アプリケーションにおける品質基準の向上を目的としており、メーカーには材料選定、処方開発、および製造プロセスのさらなる最適化が求められます。また、サプライヤーとユーザー間の技術合意においても、この新しい基準が重要な評価軸となります。

今後の展望

UL 746E-2026の施行は、北米市場におけるUV硬化型接着剤のイノベーションと品質競争を加速させるでしょう。接着剤メーカーは、より安定した硬化性能を持つ新処方の開発に注力し、テスト方法や品質管理プロセスを見直す必要があります。これにより、長期信頼性が保証された接着剤が市場に供給され、高精度製造分野における製品の安全性と信頼性が一段と向上することが期待されます。最終的には、消費者にとってより高品質で安全な製品が提供されることに繋がります。

元記事: https://www.tradeaspect360.com/news/electronic-adhesives/UV_Curing_Adhesives/UL_746E_2026_Takes_Effect_for_UV_Adhesives.html

収集日: 2026年07月10日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#05 アルケマ、Battery Show Europe 2026でEV・ESSバッテリー向けPVDFとアクリルバイNDERを発表

公開日 2026年07月07日 CoatingsPro フランス



概要

アルケマは、The Battery Show Europe 2026で、電気自動車（EV）およびエネルギー貯蔵システム（ESS）バッテリー向けに革新的な材料ソリューションを発表しました。同社は、LFPカソードの接着性とエネルギー密度を向上させる新しいPVDFグレード（Kynar® HSV 1200およびHSV 1400）を導入しました。さらに、セラミックコートセパレーター用アクリルバイNDER Incellion™ Sp 1252と接着層用PVDFコバイNDER Incellion™ Sp 450も披露し、全固体電池向けの新世代バイNDER開発も推進しています。

主要成果

アルケマは、The Battery Show Europe 2026において、電気自動車（EV）およびエネルギー貯蔵システム（ESS）バッテリーシステム向けの画期的なソリューションとイノベーションを大々的に発表しました。特に、リン酸鉄リチウム（LFP）カソードの接着性とエネルギー密度を飛躍的に向上させる新しいPVDF（ポリフッ化ビニリデン）グレードであるKynar® HSV 1200とKynar® HSV 1400を発表しました。また、セラミックコートセパレーター向けの革新的なアクリルバインダーIncellion™ Sp 1252と、接着層に用いるPVDFコバインダーIncellion™ Sp 450も披露し、次世代の全固体電池向けバインダー材料の開発も加速していることを明かしました。

技術・臨床詳細

Kynar® HSV 1200およびHSV 1400は、LFPカソードの電極構造を安定化させ、サイクル寿命と充電効率の向上に貢献します。これらのPVDFグレードは、優れた化学的安定性と電解液に対する耐性を持ち、高温環境下でも安定したバッテリー性能を維持します。Incellion™ Sp 1252アクリルバインダーは、セラミックコートセパレーターの密着性を高め、内部短絡のリスクを低減し、安全性と信頼性を向上させます。Incellion™ Sp 450 PVDFコバインダーは、接着層の強度と柔軟性を最適化し、バッテリーセル全体の機械的安定性を強化します。全固体電池向けバインダー材料の開発は、さらに高いエネルギー密度と安全性を実現するための次なるステップとして位置づけられています。

背景・業界文脈

バッテリー技術は、EVの普及と再生可能エネルギーの統合において中心的な役割を担っており、より高性能、高安全性、長寿命のバッテリー材料が強く求められています。特に、LFPバッテリーはコスト効率の良さから需要が高まっていますが、エネルギー密度と接着性能の向上が課題とされていました。また、次世代バッテリーとして期待される全固体電池は、既存のリチウムイオン電池に比べて安全性とエネルギー密度が大幅に向上すると見込まれており、その実現には革新的な材料、特に電極と固体電解質を強固に接合するバインダーが不可欠です。アルケマの今回の発表は、これらの市場ニーズに直接応えるものです。

今後の展望

アルケマが発表したこれらの新材料は、EVおよびESS市場におけるバッテリー性能の限界を押し広げ、持続可能なエネルギーソリューションの実現に大きく貢献する可能性を秘めています。LFPカソード用のPVDFグレードは、バッテリーのコストと性能のバランスを改善し、EVのコスト削減と普及を加速させるでしょう。また、全固体電池向けの新世代バインダー材料の開発は、将来のバッテリー技術のブレークスルーを可能にし、エネルギー貯蔵分野に革命をもたらすことが期待されます。アルケマは、継続的な研究開発を通じて、バッテリーエコシステムの進化を支える主要なイノベーターとしての地位を確立しています。

元記事: <https://content.ampp.org/coatingspro/magazine-article/16023/Arkema-Showcases-Innovative-Materials-at-the>

収集日: 2026年07月10日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#06 研究者らが可逆接着性とリサイクル可能なUV硬化型コーティングを開発：多層包装に新境地

公開日 2026年07月09日 European Coatings ドイツ



概要

研究者らは、基板シラン化と動的ジスルフィド化学を組み合わせることで、可逆的な接着性を有するUV硬化型コーティングを開発しました。この光開始剤フリーのシステムは、強力な接着力とオンデマンドでの剥離性を両立させることが可能です。この技術は、多層包装などのリサイクル困難な複合材料のリサイクルを可能にし、持続可能なパッケージングソリューションに新たな可能性を開きます。これは、循環型経済への移行を加速させる上で重要な進歩です。

主要成果

研究者たちは、基板シラン化と動的ジスルフィド化学を統合することにより、画期的なUV硬化型コーティングを開発しました。この新技術は、堅牢な接着性能を維持しつつ、必要に応じて剥離が可能な可逆的接着特性を兼ね備えています。さらに、このシステムは光開始剤を使用しないため、環境負荷が低く、よりクリーンな製造プロセスが実現されます。この成果は、リサイクルが困難な複合材料の課題を解決し、持続可能なパッケージングソリューションの設計に新たな道を開くものです。

技術・臨床詳細

開発されたコーティングは、基板表面をシラン化処理することで接着性を高め、その上にジスルフィド結合を含むポリマーネットワークをUV硬化させます。ジスルフィド結合は、特定の外部刺激（例えば熱や特定の化学物質）に応答して可逆的に開裂・再形成する動的な性質を持つため、コーティングのオンデマンドでの剥離や再接着が可能になります。この「光開始剤フリー」のアプローチは、従来のUV硬化プロセスで一般的に使用される光開始剤が生成する副産物による汚染や毒性の問題を回避し、より安全で環境に優しい材料を提供します。多層包装などの複合材では、異なる素材が強固に接着されているため分離が困難でしたが、この技術は層間の分離を容易にし、各素材のリサイクルを可能にします。

背景・業界文脈

パッケージング業界は、プラスチック廃棄物問題とリサイクル率向上への圧力に直面しており、多層複合材料のリサイクルは特に大きな課題となっています。従来の接着剤は非常に強固であるため、多層フィルムを構成する異なるポリマー層を効率的に分離することが困難であり、これがリサイクルプロセスの大きな障壁となっていました。本研究で示された可逆接着性コーティングは、この課題に対する有望なソリューションを提供します。これにより、多層包装を構成する各層を容易に分離し、それぞれの素材を高品質でリサイクルすることが可能となり、循環型経済の実現に大きく貢献することが期待されます。

今後の展望

この可逆接着性UV硬化型コーティング技術は、多層パッケージングだけでなく、電子機器の分解・修理、自動車部品のリサイクル、医療機器の再利用など、幅広い分野での応用が期待されます。特に、高性能と持続可能性の両立が求められる現代の製造業において、この技術は材料のライフサイクル全体にわたる環境負荷低減と資源効率の向上を実現する可能性を秘めています。研究のさらなる進展と商業化により、多くの産業で廃棄物削減とリサイクル促進に貢献する画期的な解決策となるでしょう。

元記事: <https://www.european-coatings.com/news/coatings-technologies/reversible-adhesion-in-uv-cured-coatings-via-disulfide-bonds/>

収集日: 2026年07月10日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#07 信越シリコーン、低粘度油増粘シリコーンクロスポリマーなど革新的化粧品原料を発表

公開日 2026年07月07日 Happi 日本



概要

信越シリコーンオブアメリカは、Suppliers' Day 2026で複数の新しい化粧品原料と配合例を発表しました。主要なイノベーションとして、低粘度油を増粘させるシリコーンクロスポリマーと天然由来炭化水素の独自のシリコーンゲルが挙げられます。また、軽やかな質感と優れた肌親和性を提供するアルキル/ポリグリセリン共変性シリコーンエラストマーゲルも公開され、化粧品の官能性と質感向上に貢献します。これらの新製品は、市場が求める洗練された代替品へのニーズに応えるものです。

主要成果

信越シリコーンオブアメリカは、Suppliers' Day 2026において、化粧品市場向けに複数の革新的な新原料とそれらを用いた配合例を発表しました。今回の発表の中心は、特に官能性と質感の向上に焦点を当てた製品群です。注目すべきは、低粘度油を効率的に増粘させるシリコーンクロスポリマーと、天然由来の炭化水素を組み合わせた独自のシリコーンゲルであり、これにより製品のテクスチャーと安定性が向上します。

技術・臨床詳細

新たに発表されたシリコーンゲルは、特定の低粘度油に対する優れた増粘効果を発揮し、化粧品配合において従来の増粘剤が抱えていた使用感の課題を解決します。このゲルは、天然由来の炭化水素を基材とすることで、持続可能性への配慮もなされています。さらに、アルキル/ポリグリセリン共変性シリコーンエラストマーゲルは、肌に塗布した際に非常に軽やかな感触を提供し、べたつき感を抑えつつ、高い肌親和性を実現します。これらの特性は、スキンケア製品やメイクアップ製品において、より快適な使用感と洗練された仕上がりを求める消費者ニーズに応えるものです。

背景・業界文脈

化粧品業界では、消費者が製品の性能だけでなく、使用感や肌への優しさ、さらにはサステナビリティといった多岐にわたる要素を重視する傾向が強まっています。これに伴い、原料メーカーは、従来のシリコーンの優れた特性を維持しつつ、新たな機能性や環境適合性を付加した材料の開発に注力しています。信越シリコーンの今回の新製品は、こうした市場の要請に応える形で、より自然で快適な使用感を追求するブランドにとって、魅力的な選択肢となるでしょう。

今後の展望

信越シリコーンが発表したこれらの革新的な化粧品原料は、次世代のスキンケア、メイクアップ、ヘアケア製品の処方開発において重要な役割を果たすと期待されます。低粘度油の増粘技術と軽やかな感触を提供するエラストマーゲルの組み合わせは、製品の多様化と高機能化を推進し、化粧品ブランドが競争優位性を確立する手助けとなるでしょう。信越シリコーンは、これらの新製品を通じて、市場における技術リーダーシップをさらに強化し、美の科学の進化に貢献していくと見られます。

元記事: <https://www.happi.com/breaking-news/shin-etsu-unveils-cosmetic-raw-materials-formulations-at-suppliers-day-2026/>

収集日: 2026年07月10日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#08 Dymax、光学ボンディングおよびレンズ組立向けに 低収縮・高透明度のUV硬化型光学接着剤「OPシリーズ」 を発表

公開日 2026-07-XX Intertronics イギリス



概要

Dymaxは、高性能な光学ボンディング、レンズアセンブリ、および精密フォトリソグラフィ製造向けに特別に設計されたUV硬化型光学接着剤「OPシリーズ」を発表しました。この単一成分接着剤は、数秒でUVまたは可視光硬化が可能であり、低収縮、低応力、優れた光学的透明性、および高い接着強度を実現します。また、低アウトガスで溶剤フリーの処方の特徴とし、高精度な光学アプリケーションにおける要求を高いレベルで満たします。この新製品は、光学デバイスの信頼性と生産効率を向上させる画期的なソリューションです。

主要成果

Dymaxは、高性能光学アプリケーション向けに最適化されたUV硬化型光学接着剤「OPシリーズ」を新たに発表しました。このシリーズは、光学ボンディング、レンズアセンブリ、および精密フォトリソグラフィ製造に特化して設計されており、わずか数秒でUVまたは可視光によって硬化する、光学的に透明な単一成分接着剤です。その最大の特徴は、極めて低い収縮率と応力でありながら、卓越した光学的透明性と高い接着強度を両立させる点にあります。この製品は、高精度な部品の位置決めを可能にし、光学デバイスの長期的な信頼性に貢献します。

技術・臨床詳細

Dymax OPシリーズ接着剤は、特殊なモノマーとオリゴマーの組み合わせにより、硬化時の体積収縮と内部応力を最小限に抑えています。これにより、接着された光学部品に歪みが生じるリスクが大幅に低減され、高精度の光学性能が維持されます。優れた光学的透明性は、可視光だけでなく、特定のUVおよびIR波長域でも高い透過率を維持し、光路への影響を最小限に抑えます。また、高い接着強度は、異種材料間の強固な結合を可能にし、過酷な環境下での使用にも耐えうる耐久性を提供します。さらに、この接着剤は低アウトガス特性と溶剤フリー処方により、クリーンルーム環境での使用に適しており、精密光学部品の汚染リスクを低減します。

背景・業界文脈

光学デバイス市場、特に高解像度ディスプレイ、先進運転支援システム（ADAS）用センサー、医療用イメージング機器、通信用光モジュールなどの分野では、より高性能で信頼性の高い部品が求められています。これらのデバイスの製造においては、光学部品を高精度に接着し、長期間にわたってその性能を維持することが不可欠です。従来の接着剤では、硬化収縮による歪みやアウトガスによる汚染が課題となることがありましたが、Dymax OPシリーズはこれらの課題を克服するためのソリューションを提供します。これにより、光学デバイスの設計自由度が向上し、より複雑で高性能な製品の開発が可能になります。

今後の展望

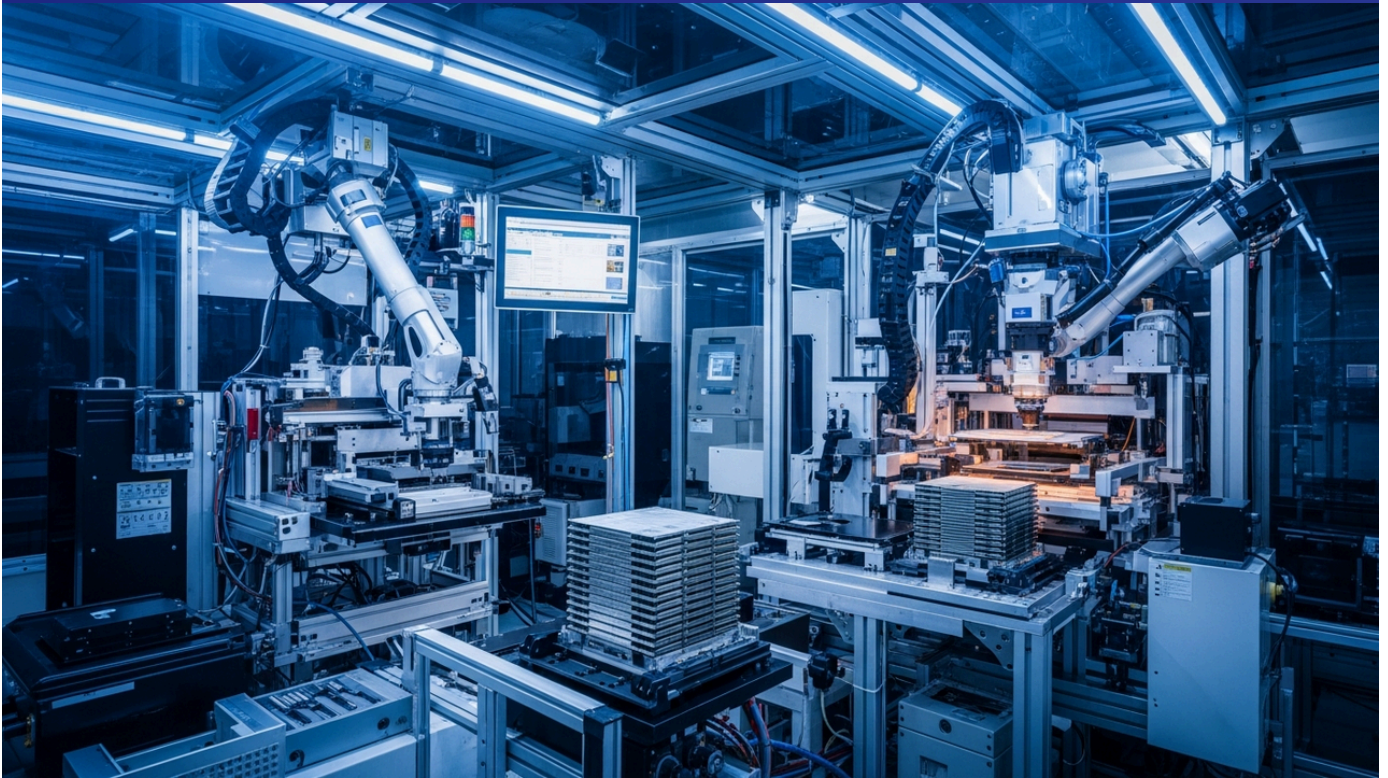
Dymax OPシリーズUV硬化型光学接着剤は、急速に進化する精密光学産業において、重要な基盤技術となることが期待されます。低収縮・高透明性という特性は、次世代の光学デバイス、特に超高精細イメージング、AR/VRヘッドセット、LiDARセンサーなど、微細な歪みも許されないアプリケーションで大きな優位性をもたらします。この製品の普及により、光学デバイスの製造プロセスの効率化と、製品の性能および信頼性の向上に大きく貢献し、最終的にはより高度な光学技術を社会に提供することに繋がるでしょう。

元記事: <https://intertronics.co.uk/product/uv-curable-optical-assembly-adhesives/>

収集日: 2026年07月10日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#09 マレーシアのコンソーシアム、高帯域幅メモリ（HBM）向け先端パッケージングのパイロットライン開発に着手

公開日 2026年07月03日 The Star マレーシア



概要

マレーシアの企業コンソーシアムであるMalaysia Advanced Packaging Consortium (MAPC) が、高帯域幅メモリ（HBM4）チップ向けの先進パッケージング技術開発とパイロットライン構築に着手しました。この取り組みには、チップパッケージングにおける接着剤やアンダーフィル材料の精密塗布装置を提供するNSW Automation社が主要な役割を担っています。このプロジェクトは、AI半導体の需要増に対応し、マレーシアを先端パッケージング分野の主要ハブとすることを目指しています。国内企業の協力により、サプライチェーン全体の強化が図られます。

主要成果

マレーシアの企業コンソーシアム「Malaysia Advanced Packaging Consortium (MAPC)」が、高帯域幅メモリ（HBM4）チップ向けの先進パッケージング技術開発とパイロットライン構築の取り組みを開始しました。このプロジェクトにおいて、NSW Automation社がチップパッケージングプロセスにおける接着剤およびアンダーフィル材料の精密塗布装置を提供することで、重要な役割を担っています。これは、AI半導体需要の急増に対応し、マレーシアを世界の先端半導体パッケージング分野における主要なプレーヤーとして位置づける戦略の一環です。

技術・臨床詳細

HBMなどの先進パッケージング技術は、複数の半導体チップを垂直方向や水平方向に高密度で統合し、データ転送速度を最大化するものです。このプロセスでは、チップ間の電氣的接続と熱管理を最適化するために、接着剤やアンダーフィル材料が不可欠です。NSW Automation社が提供する精密ディスペンス技術は、これらの材料を極めて正確に、かつ均一に塗布することを可能にし、パッケージの信頼性と性能を決定する上で重要な要素となります。特にHBM4のような次世代メモリでは、チップ積層数とデータ帯域幅の増加に伴い、接着層の薄型化と熱伝導率の向上が求められており、精密な材料塗布技術が不可欠です。

背景・業界文脈

AIや高性能コンピューティング（HPC）の台頭により、半導体チップにはこれまで以上に高い処理能力とデータ転送速度が求められています。従来の微細化技術が物理的限界に近づく中、異種集積化や3Dスタッキングといった先進パッケージング技術が、半導体性能向上の新たなフロンティアとなっています。マレーシアは長年、半導体後工程（パッケージングおよびテスト）の重要な拠点としての地位を確立しており、今回のコンソーシアムの取り組みは、その強みを活かして付加価値の高い先端パッケージング市場へシフトする動きです。この投資は、世界の半導体サプライチェーンにおけるマレーシアの戦略的重要性を示しています。

今後の展望

MAPCによるHBM4向けパイロットラインの開発は、マレーシアの半導体産業の競争力を強化し、将来のAIおよびHPC市場の成長を取り込む上で極めて重要です。NSW Automation社のような国内企業が先端材料ディスパンス技術で貢献することで、マレーシアは単なる製造拠点から、高付加価値技術開発の中心地へと進化する可能性があります。このプロジェクトの成功は、同国が世界の半導体エコシステムにおいて、先端パッケージングのイノベーションと生産能力の両面で重要な役割を果たすことを確固たるものにするでしょう。将来的には、より多くの先端パッケージング関連企業がマレーシアに誘致され、産業クラスターがさらに発展することが期待されます。

元記事: <https://www.thestar.com.my/business/business-news/2026/07/04/the-advanced-packaging-race>

収集日: 2026年07月10日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#10 Amkor Technology、SEMI Advanced Packaging Summit 2026でAI時代におけるパワーモジュールパッケージング技術を発表

公開日 2026年07月06日 Amkor Technology 韓国



概要

Amkor Technologyは、2026年7月15日に開催されるSEMI Advanced Packaging Summit 2026に参加し、上級副社長のShinji Baba氏が「先進パワーモジュールパッケージング技術」について発表します。このプレゼンテーションでは、AI時代におけるパワーデバイスおよびパワーモジュールパッケージングの最新トレンド、電気的および熱的課題、先進的な相互接続、冷却アーキテクチャ、およびAmkorの技術ロードマップが詳細に議論されます。これは、高性能コンピューティングとAIアプリケーションの需要増に対応するための重要なパッケージング技術の進展を示すものです。

主要成果

Amkor Technology は、2026 年 7 月 15 日に開催される「SEMI Advanced Packaging Summit 2026」に登壇し、同社のShinji Baba氏が「先進パワーモジュールパッケージング技術」と題する基調講演を行います。このプレゼンテーションでは、AIと高性能コンピューティング（HPC）の時代において不可欠となる、パワーデバイスおよびパワーモジュールパッケージングの最前線のトレンドと、それに伴う電気的および熱的な課題、そして革新的な相互接続および冷却アーキテクチャに関するAmkorの洞察が示されます。これは、データセンターや電気自動車などの高出力アプリケーションにおける半導体の信頼性と効率を向上させる上で極めて重要な情報です。

技術・臨床詳細

AIやHPCアプリケーションの急速な進化は、半導体デバイスに前例のない電力密度と熱管理能力を要求しています。従来のパッケージング技術では、この要求に応えることが困難になりつつあります。Shinji Baba氏の発表では、特に以下のような技術的詳細が議論される予定です。

- **先進的な相互接続技術:** 高電流密度に対応し、寄生抵抗とインダクタンスを最小限に抑えるための新しいボンディング技術やリードフレーム設計。
- **効率的な冷却アーキテクチャ:** デバイスから発生する大量の熱を効果的に放散するための高度な熱界面材料（TIM）、ヒートシンク設計、および液冷技術。
- **材料科学の進歩:** 高温環境下でも安定した性能を維持するための封止材、基板材料、および接着剤の選定と最適化。
- **統合されたパッケージングソリューション:** 複数の機能ブロックを一つのパッケージに統合し、システムの小型化と性能向上を実現するアプローチ。

背景・業界文脈

SEMI Advanced Packaging Summit 2026は、「AIの未来をパッケージングする – シリコンからフォトンへ」をテーマに掲げ、AI時代におけるパッケージング技術の進化と半導体産業への広範な影響を議論する主要なイベントです。AI半導体は、その計算能力の高さゆえに大量の熱を発生させ、安定動作のためには高性能な放熱ソリューションが不可欠です。Amkor Technologyのような主要なOSAT（Outsourced Semiconductor Assembly and Test）プロバイダーは、このような課題に対応するための先進パッケージング技術の開発において中心的な役割を果たしています。同社の技術ロードマップは、業界全体の発展方向性を示す重要な指標となります。

今後の展望

Amkor Technologyのプレゼンテーションは、AIとHPCアプリケーションにおける次世代パワーモジュールパッケージングの方向性を明確に示すものであり、半導体設計者、エンジニア、および投資家にとって、今後の技術動向を理解するための貴重な情報を提供します。同社の先進的なアプローチは、より電力効率が高く、信頼性の高いAIシステムや電気自動車の実現に貢献し、関連産業全体の技術革新を加速させることが期待されます。このサミットでの発表は、業界が直面する課題を克服し、持続可能な技術発展を推進するための重要なステップとなるでしょう。

元記事: <https://amkor.com/events/advanced-packaging-summit-2026/>

収集日: 2026年07月10日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#11 Amkor Technology、ECTC 2026でAI・HPC向けガラスコア基板の大型パッケージング性能評価を発表

公開日 2026年07月06日 Amkor Technology 韓国



概要

Amkor Technologyは、電子パッケージングの主要なフォーラムであるECTC 2026において、JongMin Park氏が「AIおよびHPCアプリケーション向けガラスコア基板の大型パッケージング性能評価」に関する技術ポスターを発表しました。この発表は、Amkorが先進パッケージング技術、特にAIと高性能コンピューティングの要求を満たすための新しい基板材料の研究開発に貢献していることを強調するものです。ガラスコア基板は、従来の有機基板と比較して優れた電気的特性と熱的安定性を提供し、次世代の高密度パッケージングを実現する鍵となります。

主要成果

Amkor Technologyは、電子パッケージング業界における権威あるフォーラムである ECTC 2026（2026年5月26日～29日開催）に参加し、JongMin Park氏が「AIおよびHPCアプリケーション向けガラスコア基板の大型パッケージング性能評価」と題する重要な技術ポスターを発表しました。この発表は、Amkorが次世代の高性能コンピューティングおよび人工知能アプリケーションを支えるための先進パッケージング技術、特に新しい基板材料の研究開発において積極的に貢献していることを明確に示しています。

技術・臨床詳細

このポスター発表では、AIおよびHPCデバイスの進化に伴い、より高い電力供給能力、低信号損失、優れた熱管理が要求される中、ガラスコア基板が従来の有機基板に代わる有望なソリューションとして評価された具体的な成果が紹介されました。ガラスコア基板は、その滑らかな表面、優れた寸法安定性、および熱膨張係数の低さから、微細配線形成や高密度実装に適しています。発表では、特に大型パッケージングにおけるガラスコア基板の反り（warpage）や応力分布の評価、および電氣的性能と熱伝導特性に関する詳細なシミュレーションと実験データが提示されました。これにより、ガラスコア基板がAIチップやHPCプロセッサの性能を最大限に引き出すための鍵となる材料であることが実証されました。

背景・業界文脈

半導体業界では、ムーアの法則の限界が近づく中で、パッケージング技術が性能向上の新たなフロンティアとなっています。AIやHPCのワークロードは、チップ設計だけでなく、複数のチップを高密度に集積し、効率的なデータ転送と熱放散を可能にする先進パッケージング材料と構造に大きく依存しています。ガラスコア基板は、有機基板に比べて信号伝送損失が少なく、熱膨張係数がシリコンに近いという利点を持つため、高密度で高速な異種集積パッケージングにおいて大きな注目を集めています。Amkorのこの研究は、このような業界の動向に直接応えるものです。

今後の展望

Amkor Technologyによるガラスコア基板の大型パッケージング性能評価に関する研究は、AIおよびHPCアプリケーションの将来の発展に不可欠な技術的基盤を提供します。この技術がさらに成熟し、量産化されれば、より高性能でエネルギー効率の高いAIアクセラレータやHPCシステムが実現可能となり、データセンターの性能向上や新たなAIサービスの創出を加速させるでしょう。Amkorの継続的な研究開発は、先進パッケージング分野における同社のリーダーシップを強化し、半導体エコシステム全体の革新に貢献することが期待されます。

元記事: <https://amkor.com/events/events-ectc-2026/>

収集日: 2026年07月10日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#12 3Mが2026年第2四半期決算発表を7月21日に予定、産業・電子・ヘルスケア市場での多様な製品ポートフォリオを強調

公開日 2026年07月10日 MarketBeat アメリカ



概要

3Mは、2026年第2四半期決算報告を2026年7月21日に発表すると通知しました。この財務発表は、3Mの広範な製品ポートフォリオに焦点を当て、接着剤やテープを含む多様な製品が産業、輸送、エレクトロニクス、ヘルスケア、消費者市場といった主要な分野で展開されていることを示します。同社は化学、機械、電子材料の専門知識を統合し、これらの市場に特殊なソリューションを提供しています。決算報告は、同社の事業戦略と市場パフォーマンスに関する詳細な洞察を提供するでしょう。

主要成果

3Mは、2026年第2四半期の決算報告を2026年7月21日に発表する予定であることを通知しました。この発表は、同社が産業、輸送、エレクトロニクス、ヘルスケア、消費者市場など多岐にわたる分野で展開している、接着剤やテープを含む幅広い製品ポートフォリオに光を当てることが予想されます。3Mは、化学、機械、電子材料の深い専門知識を組み合わせることで、各市場セグメントに特化したソリューションを提供し続けています。

技術・臨床詳細

3Mの製品は、その革新的な材料科学とエンジニアリングの融合によって支えられています。例えば、接着剤技術においては、自動車の軽量化、航空宇宙部品の接合、電子デバイスの熱管理、医療用ウェアラブルの生体適合性接着など、様々な高機能アプリケーションに対応する製品を提供しています。テープ製品もまた、産業用途での強力な固定から、ヘルスケア分野での皮膚に優しい医療用テープまで、幅広いニーズに応えるために精密に設計されています。これらの製品は、継続的な研究開発と品質管理プロセスによって、各市場の厳しい要求を満たしています。

背景・業界文脈

3Mは、世界をリードする多角的な技術企業として、そのイノベーションの歴史と広範な製品群で知られています。同社の事業は、経済の様々なセクターと密接に結びついており、グローバルな産業トレンドや消費者の需要変動に敏感に反応しています。特に、接着剤とシーラント市場は、持続可能な処方、電気自動車の普及、グリーンビルディングの進展、エレクトロニクスの小型化などの主要な推進要因によって成長が予測されており、3Mの戦略的な位置づけはその恩恵を受ける可能性があります。過去には、ATP Adhesive SystemsやStahlといった企業の買収を通じて、接着技術ポートフォリオを強化してきました。

今後の展望

2026年第2四半期決算報告は、3Mが現在の市場環境にどのように対応し、成長戦略を実行しているかについて重要な洞察を提供するでしょう。同社の収益成長は、接着技術部門を含む両事業部門によって牽引される可能性が高く、プラスの販売量と価格変動が期待されます。また、完了した10億ユーロ規模の自社株買いプログラムなど、財務戦略も今後の株価動向に影響を与える要因となります。3Mは、継続的なイノベーションと戦略的投資を通じて、多角的な事業基盤をさらに強化し、長期的な成長を目指していくと見られます。

元記事: <https://www.marketbeat.com/earnings/reports/2026-7-21-3m-stock/>

収集日: 2026年07月10日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#13 コベストロ、HDI誘導体生産工場をタイと米国で買収しグローバル生産能力を拡大

公開日 2026年07月02日 Plastics Today ドイツ



概要

コベストロは、タイのラヨンと米国テキサス州フリーポートにある旧VencorexのHDI誘導体生産工場2拠点の買収を完了しました。この戦略的な買収により、コベストロはヘキサメチレンジイソシアネート（HDI）誘導体のグローバル生産拠点を拡大し、コーティングおよび接着剤産業の顧客への供給能力を大幅に強化します。今回の投資は、世界的に高まる需要に対応し、主要市場での顧客への安定供給を確保するためのコベストロのコミットメントを示すものです。

主要成果

コベストロは、タイのラヨンと米国テキサス州フリーポートに位置する、旧Vencorexが保有していたヘキサメチレンジイソシアネート（HDI）誘導体生産工場2拠点の買収を完了したことを発表しました。この戦略的な買収は、コベストロのHDI誘導体のグローバル生産能力を大幅に拡大し、特に成長著しいコーティングおよび接着剤産業の顧客への供給安定性を強化するものです。

技術・臨床詳細

HDI誘導体は、高品質なポリウレタンコーティングや接着剤の製造において不可欠な中間体です。これらは、自動車、建築、家具、電子機器など、幅広い分野で優れた耐久性、耐候性、および審美性を要求される製品に使用されます。今回の買収により、コベストロは、これら重要材料の生産を地理的に多様化し、生産拠点を増やすことで、グローバルなサプライチェーンの強靱性を向上させます。これにより、原材料供給の安定性が確保され、顧客は中断なく製品開発と生産を進めることが可能になります。

背景・業界文脈

コーティングおよび接着剤市場は、持続可能性への要求、軽量化トレンド、および高性能材料への需要増加により、堅調な成長を続けています。特に、環境規制の強化に伴い、低VOC（揮発性有機化合物）や水性システムへの移行が進んでおり、HDI誘導体はそのような高性能環境対応型製品の鍵となる成分です。コベストロは、これらの市場動向を背景に、グローバルな生産体制を強化することで、顧客のイノベーションと持続可能性目標達成をサポートする能力を向上させることを目指しています。

今後の展望

今回の買収は、コベストロがポリウレタン材料の世界的リーダーとしての地位をさらに確固たるものにするための重要な一歩です。生産拠点の拡大と地理的分散は、市場の変動に対する耐性を高め、地域の顧客ニーズへの対応力を向上させます。これにより、コベストロは長期的な成長戦略を加速させ、高性能コーティングおよび接着剤市場における主要サプライヤーとしての競争優位性を維持していくでしょう。最終的には、自動車、建築、家具などの最終製品の品質向上と持続可能性に貢献することが期待されます。

元記事: <#>

収集日: 2026年07月10日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#14 LyondellBasellとMondelezが協業し、75%リサイクルプラスチック由来のMarabouチョコレート包装を商業化

公開日 2026年07月07日 LyondellBasell - Investors オランダ



概要

LyondellBasell (LYB)とMondelez Internationalは、Marabouチョコレートバー向けの革新的なフレキシブルパッケージングソリューションを発表しました。この新しい包装は、ISCC PLUS認証のマスバランスアプローチを通じて、100%リサイクルコンテンツを持つLYB CirculenReviveポリマーを使用しており、全体で75%のリサイクルプラスチックから作られています。これは、プラスチック廃棄物問題への具体的な解決策を提供し、食品包装における循環経済を推進する画期的な進展です。両社の協力は、消費者が日常的に使用する製品において持続可能性を向上させる重要な一歩となります。

主要成果

LyondellBasell (LYB)とMondelez Internationalは、スウェーデンの人気チョコレートブランドMarabouのチョコレートバー向けに、画期的なフレキシブルパッケージングソリューションを共同で開発しました。この新しい包装は、ISCC PLUS認証を受けたマスバランスアプローチを通じて、100%リサイクルコンテンツを含むLYBのCirculenReviveポリマーを基盤としており、全体として75%のリサイクルプラスチックから製造されています。これは、食品包装分野における循環経済への移行を加速させる上で重要なマイルストーンとなります。

技術・臨床詳細

CirculenReviveポリマーは、高度なリサイクルプロセス、特にケミカルリサイクル技術によって生産され、使用済みプラスチックを元のモノマーまたは中間体に分解し、新しいバージン品質のポリマーを製造します。ISCC PLUS認証のマスバランスアプローチは、リサイクル原料と化石燃料由来原料が物理的に混合される生産システムにおいて、リサイクルコンテンツがサプライチェーン全体で追跡・配分されることを保証するものです。これにより、Mondelez Internationalは、製品の安全性や品質を損なうことなく、高い割合でリサイクルされたプラスチックを食品接触用途の包装に利用することが可能となります。

背景・業界文脈

消費財業界、特に食品包装分野は、プラスチック廃棄物の削減とリサイクル率の向上という大きな課題に直面しています。フレキシブルパッケージングは、その機能性やコスト効率の高さから広く利用されていますが、その複雑な構成ゆえにリサイクルが難しい場合が多いのが現状です。欧州では、使い捨てプラスチック指令などの規制強化も進んでおり、企業にはより持続可能な包装ソリューションへの移行が求められています。LYBとMondelezの協業は、こうした業界全体の課題に対し、具体的な技術的解決策と商業的な実行可能性を示すものです。

今後の展望

このリサイクルプラスチックを使用したMarabouチョコレート包装の商業化は、消費財ブランドがプラスチック廃棄物削減目標を達成するための強力なモデルとなるでしょう。LYBのCirculenReviveポリマーのような革新的な材料は、食品の安全性と品質を確保しつつ、パッケージングの持続可能性を大幅に向上させる可能性を秘めています。今後、このアプローチが他の製品ラインやブランドにも拡大され、食品業界全体でリサイクルコンテンツを含む包装材料の採用が加速することが期待されます。これにより、プラスチックの循環型経済への貢献がさらに促進されるでしょう。

元記事: <https://investors.lyondellbasell.com/news/news-details/2026/From-plastic-waste-to-chocolate-wrappers-LYB-and-Mondelez-collaborate-on-Marabou-flexible-packaging-sourced-from-recycled-plastic/default.aspx>

収集日: 2026年07月10日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#15 DELO、バイオベース成分を主とした高性能多目的接着剤「PHOTOBOND SJ4192」を発表

公開日 2026年07月02日 DELO Press Release ドイツ



概要

DELOは、主にバイオベースの成分から構成され、優れた性能と持続可能性を兼ね備えた新しい多目的接着剤「DELO PHOTOBOND SJ4192」を開発しました。この接着剤は、金属、ガラス、プラスチックといった多様な材料に対して強固な接着力を発揮します。半導体パッケージング、自動車、家電、医療技術など、幅広い産業分野での応用が可能であり、高性能接着剤における環境配慮型ソリューションへの需要に応えるものです。この製品は、高い技術的要件を満たしつつ、資源効率の向上に貢献します。

主要成果

DELOは、主にバイオベースの成分からなる画期的な多目的接着剤「DELO PHOTOBOND SJ4192」を開発しました。この新しい接着剤は、卓越した接着性能と環境持続可能性を両立させています。金属、ガラス、プラスチックを含む様々な基材に対して強固な結合力を発揮し、半導体パッケージング、自動車産業、家電、そして医療技術といった多岐にわたる高技術分野での広範な応用が期待されます。この製品は、高性能接着ソリューションにおける環境配慮型イノベーションの進展を示すものです。

技術・臨床詳細

DELO PHOTOBOND SJ4192は、その主要成分が植物由来やその他の再生可能資源から抽出されたバイオベース物質であるという点で革新的です。このバイオベース処方により、化石燃料への依存度を低減し、製品のカーボンフットプリント削減に貢献します。接着性能に関しては、特許取得済みの配合技術により、異なる材料間でも高いせん断強度と剥離強度を達成しています。例えば、ガラスと金属の接合、プラスチック部品の精密接着において、優れた耐久性と信頼性を提供します。また、硬化速度が速く、プロセス効率の向上にも寄与するため、高スループットが求められる自動化された生産ラインにも適しています。

背景・業界文脈

接着剤市場は、環境意識の高まりと規制強化により、持続可能な材料への移行が加速しています。多くの産業で、従来の石油化学ベースの接着剤に代わる、環境に優しく、かつ性能面で妥協のないソリューションが求められています。半導体、自動車、医療といった分野では、接着剤は小型化、軽量化、および特定の機能性（例えば熱管理や振動減衰）を実現するための重要な要素であり、その選択は最終製品の性能と信頼性を大きく左右します。DELOのPHOTOBOND SJ4192は、これらの厳しい技術的要件を満たしながら、環境目標にも貢献するソリューションとして注目されます。

今後の展望

DELO PHOTOBOND SJ4192の登場は、高性能接着剤市場におけるバイオベース材料の採用を促進する重要な推進力となるでしょう。この製品は、企業が持続可能性目標を達成するのを支援し、同時に最終製品の品質と競争力を向上させる可能性を秘めています。DELOは、この新しい接着剤を通じて、環境に配慮した技術革新をリードし、顧客が直面する複雑な接着課題に対して、よりグリーンで効率的な解決策を提供していくことが期待されます。将来的には、より多くの産業でバイオベース接着剤の採用が進み、循環型経済への貢献が加速するでしょう。

元記事: <https://www.delo-adhesives.com/news-and-dates/press-and-media/press-release/>

収集日: 2026年07月10日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#16 住友ベークライト、2026年設備投資をアジア製造拠点に再編し、営業利益35.7%拡大で脱コモディティ化を加速

公開日 2026年07月07日 HDIN Research 日本



概要

住友ベークライトは、2026年の設備投資戦略をアジア地域の半導体封止材料製造拠点に再編・集中すると発表しました。同社の営業利益は35.7%という大幅な拡大を記録しており、これは半導体材料のスループットが横ばいにもかかわらず、高付加価値製品へのシフトによる構造的な「脱コモディティ化」が進んでいることを示唆しています。この投資は、特にAIや高性能コンピューティング向け先端パッケージング材料の需要増に対応し、技術リーダーシップを強化することを目的としています。同社は、特定の高成長市場セグメントで競争力を高める方針です。

主要成果

住友ベークライトは、2026年の設備投資（CapEx）戦略をアジア地域の製造拠点に再編・集中することを発表しました。この動きは、半導体封止材料の生産能力をさらに強化することを目的としています。同社は、半導体材料のスループットが横ばいであるにもかかわらず、営業利益が35.7%という顕著な拡大を達成しており、これは高付加価値製品へのシフトによる構造的な「脱コモディティ化」が成功裏に進展していることを明確に示しています。

技術・臨床詳細

住友ベークライトの半導体封止材料は、AI、高性能コンピューティング（HPC）、5G通信など、高度なエレクトロニクスデバイスに不可欠なコンポーネントです。これらの材料は、半導体チップを外部環境から保護し、熱放散を効率的に行うことで、デバイスの信頼性と寿命を大幅に向上させます。今回の設備投資の再編は、特に次世代のフリップチップ、WLP（ウェハーレベルパッケージング）、SIP（システムインパッケージ）といった先端パッケージング技術に対応するための生産ラインの近代化と拡張に焦点を当てています。これにより、より微細なピッチ、高い熱伝導率、および低応力特性を持つ封止材料の供給能力が強化されます。

背景・業界文脈

半導体業界では、プロセス微細化の物理的限界が近づく中、性能向上とコスト削減の新たな手段として先進パッケージング技術の重要性が増しています。特にAIおよびHPCのアプリケーションは、高密度集積と高放熱性を持つパッケージングを要求しており、これに対応する高性能な封止材料が不可欠です。住友ベークライトの収益性の向上は、同社が標準的な汎用製品から、特定の高性能市場セグメントに特化した差別化されたソリューションへと成功裏にシフトしていることを示しています。アジア地域は世界の半導体製造の中心地であり、この地域への投資集中は、サプライチェーンの効率性と顧客への迅速な対応を保証する戦略的な決定です。

今後の展望

今回の設備投資再編と営業利益の顕著な拡大は、住友ベークライトが先端半導体材料市場におけるリーダーシップをさらに強化する基盤を築くものです。高付加価値製品への戦略的転換とアジア製造拠点への投資集中は、同社がグローバルな競争力を維持し、将来の技術革新の波に乗り続けるための重要なステップとなります。これにより、AIやHPCといった成長分野での市場シェアを拡大し、収益性の高い事業構造を確立することが期待されます。住友ベークライトは、継続的な技術革新を通じて、半導体エコシステム全体の発展に貢献していくでしょう。

元記事: <https://www.hdinresearch.com/news/1655>

収集日: 2026年07月10日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#17 Indium Corporation 専門家がIMAPS ThermConでAI熱課題向けTIMソリューションを発表

公開日 2026年07月02日 Indium Corporation アメリカ



概要

Indium Corporationの専門家であるRyan Mayberry氏が、IMAPS ThermConでAI時代における熱課題に対するTIM（熱界面材料）ソリューションに関する研究を発表します。この研究は、高出力レーザーやRFアプリケーション向けに設計された金ベースの精密ダイアタッチプリフォームや、5G通信におけるデバイスの信頼性向上に貢献します。高度な熱管理ソリューションは、AIおよび高性能コンピューティングデバイスの持続的な性能と安定動作を確保するために不可欠です。

主要成果

Indium Corporationの技術専門家であるRyan Mayberry氏が、IMAPS ThermConにて、人工知能（AI）システムが直面する熱課題に対処するためのTIM（熱界面材料）ソリューションに関する研究成果を発表します。この発表は、高出力レーザーやRF（高周波）アプリケーション向けに最適化された金ベースの精密ダイアタッチプリフォームの技術革新、および5G通信インフラにおけるデバイスの長期信頼性向上への貢献に焦点を当てています。これは、AIおよび高性能コンピューティング（HPC）デバイスの安定した動作と性能維持に不可欠な、先進的な熱管理技術の進展を示すものです。

技術・臨床詳細

発表されるTIMソリューションは、主に以下の技術的側面を含んでいます。

- **金ベースの精密ダイアタッチプリフォーム:** 高出力デバイスにおいて、半導体チップとヒートシンク間の熱抵抗を最小化し、優れた熱伝導性を確保するために設計された、高純度で高信頼性の金合金製接合材料。これにより、過酷な動作条件下でもチップのジャンクション温度を低く保ち、デバイス寿命と性能を最大化します。
- **高熱伝導性材料:** AIプロセッサやRFパワーアンプから発生する大量の熱を効率的に外部へ排出するための、熱伝導率に優れた接着剤やグリースなどの界面材料。
- **低応力特性:** 温度サイクルによる熱膨張係数のミスマッチから生じる応力を軽減し、パッケージの信頼性を高める材料設計。

これらの技術は、データセンター、エッジAIデバイス、5G基地局といったアプリケーションにおいて、システムの安定稼働とエネルギー効率の向上に直接貢献します。

背景・業界文脈

AIおよびHPCの急速な発展は、半導体デバイスの消費電力と発熱量を劇的に増加させています。特に、多層化されたCPU/GPU、HBM（高帯域幅メモリ）、および高周波パワーアンプでは、効果的な熱管理がデバイスの性能、信頼性、および寿命を決定する上で最も重要な課題の一つとなっています。TIMは、発熱体と冷却装置の間のギャップを埋め、熱伝達効率を最大化する上で不可欠な要素です。Indium Corporationの研究は、このような業界の喫緊の課題に対し、具体的な材料ソリューションを提供することで、AIインフラの進化を物理的側面から支えるものです。

今後の展望

Indium CorporationのTIMソリューションに関する研究発表は、AIおよび5G時代における熱管理技術の将来の方向性を示す重要な洞察を提供します。高出力デバイスの熱的制約を克服することは、AIアプリケーションのさらなる進化と、5Gネットワークの広範な展開に不可欠です。これらの先進的なTIM技術が市場に導入されることで、より高性能で信頼性の高いAIサーバー、自律走行システム、そして次世代通信機器の実現が加速するでしょう。Indium Corporationは、継続的な材料科学の革新を通じて、次世代エレクトロニクスの発展に貢献していくと期待されます。

元記事: <#>

収集日: 2026年07月10日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#18 H.B. Fuller、ポートフォリオ再編とフロアリング事業売却により高価値市場を優先し、売上高5.8%増と利益率向上を達成

公開日 2026年07月09日 Zacks.com アメリカ



概要

H.B. Fullerは、戦略的なポートフォリオ再編とフロアリング事業の売却を完了し、高価値な特殊接着剤市場への集中を加速しています。同社は直近の第2四半期において、売上高を5.8%増加させ、製品構成の最適化、リストラによる費用削減、および価格設定戦略の成功により、少量ながらも利益率の大幅な改善を達成しました。この動きは、収益性の高いセグメントに焦点を当てることで、同社の財務パフォーマンスと市場競争力を強化することを目的としています。H.B. Fullerは、継続的なポートフォリオの最適化を通じて、持続可能な成長を目指します。

主要成果

H.B. Fullerは、戦略的なポートフォリオの再編とフロアリング事業の売却を成功裏に完了した後、より高価値な特殊接着剤市場への集中を加速させています。直近の第2四半期において、同社は売上高を前年同期比で5.8%増加させ、同時に製品構成の最適化、リストラによる費用削減、および効果的な価格設定戦略の実施を通じて、販売量は減少したものの、利益率の大幅な改善を達成しました。この成果は、高成長・高収益セグメントへの戦略的転換が奏功していることを示しています。

技術・臨床詳細

H.B. Fullerは、自動車、医療、エレクトロニクス、包装などの特殊接着剤分野で、高性能ソリューションを提供しています。ポートフォリオ再編は、特にこれらの高付加価値市場における研究開発と製品イノベーションへの投資を強化することを目的としています。同社の接着剤は、極限環境下での性能、特定の素材への適合性、持続可能性要件（低VOC、バイオベース成分など）など、顧客の特定のニーズに応えるように設計されています。フロアリング事業の売却により、リソースをより戦略的な事業に集中させ、これらの分野での技術リーダーシップをさらに強化することが可能になります。

背景・業界文脈

接着剤市場全体は、建設、自動車、包装、エレクトロニクス、ヘルスケアなど幅広い産業での需要増加により成長を続けています。しかし、不安定な投入コスト、厳格化する化学物質規制、および特定のアプリケーションからの新たな需要（例えば、EVバッテリーの熱管理、エレクトロニクスの小型化）は、接着剤メーカーにポートフォリオの最適化と高付加価値化を促しています。H.B. Fullerの動きは、このような業界の動向に適合し、コモディティ製品の競争から脱却し、技術とイノベーションを基盤とした特殊市場での優位性を確立しようとするものです。また、Arkema、Sika、Dowといった主要企業も持続可能性規制への対応として、高度な配合技術に投資しており、H.B. Fullerも同様の戦略を取っています。

今後の展望

H.B. Fullerのポートフォリオ再編と高価値市場への集中は、長期的な収益性と持続可能な成長のための強固な基盤を築くものです。利益率の改善は、同社が今後も同様の戦略を推進し、選択的なM&Aを通じて技術ポートフォリオをさらに強化する可能性を示唆しています。特殊接着剤市場でのリーダーシップを確立することで、H.B. Fullerは、革新的なソリューションを提供し続け、顧客の最も困難な接着課題を解決する上で重要な役割を果たすことが期待されます。これにより、同社は競争の激しい接着剤市場において、安定した成長と高収益性を維持していくでしょう。

元記事: <https://www.zacks.com/stock/news/2950688/hb-fuller-stock-outlook-hinges-on-margins-mix-and-ma>

収集日: 2026年07月10日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#19 TSMCがリードする後工程エコシステム再編加速、先端パッケージングが半導体競争環境を再構築

公開日 2026年07月09日 The Economy 台湾



概要

先端パッケージング技術は、半導体産業における新たな競争領域として急速に台頭しており、従来のプロセス微細化が技術的限界に近づく中でその重要性を増しています。複数のチップを高密度に統合して全体的な性能を向上させるパッケージング技術が、競争力の重要な決定要因となりつつあります。TSMCは、このトレンドに対応するため、先進パッケージングへの投資を積極的に強化しており、後工程エコシステムの再編を主導しています。これにより、半導体設計と製造の境界線が曖昧になり、新たな価値創造の機会が生まれています。

主要成果

先端パッケージング技術が半導体産業における新たな競争の主戦場として急速に浮上しています。従来のプロセス微細化技術が物理的限界に直面する中、複数のチップを高密度に統合し、システム全体の性能を飛躍的に向上させるパッケージング手法が、半導体メーカーの競争力を左右する最も重要な要素となっています。世界的なファウンドリリーダーであるTSMCは、この技術革新の波に積極的に対応するため、先進パッケージング分野への投資を大幅に強化し、後工程エコシステムの再編を主導しています。

技術・臨床詳細

先端パッケージング技術は、2.5Dや3D集積、ファンアウトウェハーレベルパッケージング（FOWLP）、システムインパッケージ（SiP）ソリューションなど多岐にわたります。これらの技術は、異なる機能を持つチップ（CPU、GPU、メモリなど）を近接して配置し、短い配線で接続することで、データ転送速度を高速化し、消費電力を削減します。例えば、CoWoS（Chip-on-Wafer-on-Substrate）やInFO（Integrated Fan-Out）といったTSMCの主要な先進パッケージング技術は、インターポーザやRDL（再配線層）を通じて、チップ間の接続密度と効率を最大化します。これらのプロセスでは、精密なダイアタッチ、アンダーフィル、モールド材料、および熱界面材料（TIM）が不可欠であり、パッケージ全体の性能と信頼性を決定します。

背景・業界文脈

半導体業界は、長年にわたりムーアの法則に従って微細化を進めてきましたが、物理法則と製造コストの制約により、このペースは鈍化しています。代わりに、パッケージング技術による「システムレベルの性能向上」が注目を集めるようになりました。AI、高性能コンピューティング（HPC）、5G、自動運転といった新たなアプリケーションは、チップレベルでの高性能化だけでなく、複数のチップを効率的に統合するパッケージング技術を強く求めています。TSMCのようなファウンドリが後工程に大規模投資を行うことは、従来の前工程と後工程の間の境界を曖昧にし、設計から製造、パッケージングまでを一貫して最適化する新たなビジネスモデルを形成するものです。

今後の展望

TSMC主導による先進パッケージングへの投資と後工程エコシステムの再編は、半導体業界全体のサプライチェーンに大きな影響を与えるでしょう。高性能パッケージング材料（例：2.5Dおよび3D Cu-Cuハイブリッドボンディング材料、エポキシモールドイングコンパウンド、モールドイングアンダーフィル、ガラスパネルベースのパッケージング技術）の開発と採用が加速し、関連する材料メーカーや装置メーカーに新たなビジネスチャンスが生まれます。この動きは、半導体技術の次のブレークスルーを推進し、より革新的で高性能な電子機器の実現に貢献すると同時に、半導体産業における競争構造を根本的に変革する可能性を秘めています。

元記事: <https://economy.ac/news/2026/07/202607289515>

収集日: 2026年07月10日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#20 半導体パッケージの反り問題にマイクロCTが有効な非破壊3D解析アプローチとして注目

公開日 2026年07月09日 AZoM イギリス

TECHNOLOGY
NEWS

Micro-CT as effective non-destructive 3D analysis approach for semiconductor warpage problems



Published July 9, 2026 | United Kingdom

AZoM | United Kingdom

概要

半導体パッケージの反り（warpage）は、パッケージの性能と信頼性を著しく損なう主要な課題として浮上しています。この変形は、基板、シリコン、モールドディングコンパウンドなどのパッケージ構成材料間の熱膨張係数の不一致や、封止材料の熱的・化学的収縮に起因します。マイクロCT（X線マイクロトモグラフィー）は、この複雑な反り現象を非破壊的に3次元で詳細に解析する上で非常に有効なアプローチとして注目されており、パッケージングプロセスの最適化と信頼性向上に貢献します。正確な3Dデータは、設計と材料選定の改善に不可欠です。

主要成果

半導体パッケージの反り（warpage）は、デバイスの性能と信頼性を低下させる重大な課題であり、特に小型化・高密度化が進む現代の半導体製造においてその影響は増大しています。この複雑な変形現象は、パッケージを構成する複数の材料（基板、シリコンチップ、モールディングコンパウンドなど）の熱膨張係数（CTE）の不一致や、封止材料の硬化時の熱的・化学的収縮によって引き起こされます。この課題に対し、マイクロCT（X線マイクロトモグラフィー）が、反りを非破壊的かつ高解像度で3次元的に解析する非常に有効なアプローチとして、業界内で大きな注目を集めています。

技術・臨床詳細

マイクロCTは、X線を利用してサンプルを透過させ、多角的に撮影した画像をコンピューター処理することで、サンプルの内部構造を3次元的に再構築する技術です。この手法を用いることで、接着剤層、アンダーフィル材料、モールディングコンパウンド、基板、シリコンチップといったパッケージ内の各構成要素における微細な変形や応力分布を、サンプルを破壊することなく詳細に可視化できます。特に、反りの発生源となるCTEミスマッチや硬化収縮がどのようにパッケージ構造全体に影響を及ぼしているかを、ミリメートルからマイクロメートルレベルの精度で評価することが可能です。これにより、設計段階でのシミュレーション結果と実際の反り挙動を比較検証し、材料選定やプロセス条件の最適化に役立つ貴重なデータが得られます。

背景・業界文脈

半導体デバイスの高性能化と小型化が進むにつれて、パッケージング技術はますます複雑化しています。フリップチップ、SIP（システムインパッケージ）、TSV（Through-Silicon Via）などの先端パッケージング技術では、チップと基板間の接続密度が高く、わずかな反りでも電氣的接続不良や熱的性能の低下を引き起こす可能性があります。特に、異種材料を積層する際に生じる熱的応力は避けられない問題であり、これを正確に理解し制御することがパッケージの信頼性を確保する上で不可欠です。マイクロCTによる非破壊的な3D解析は、従来の2D測定や破壊検査では得られなかった深層的な知見を提供し、迅速な問題解決と開発サイクルの短縮に貢献します。

今後の展望

マイクロCT技術は、半導体パッケージの反り解析におけるデファクトスタンダードとなる可能性を秘めています。この技術の活用により、半導体メーカーは、より堅牢で信頼性の高いパッケージデザインを迅速に開発し、製造プロセスを最適化できるようになります。また、新素材の導入評価や品質管理においても、その役割は拡大するでしょう。将来的には、AIと組み合わせた自動欠陥検出や予知保全への応用も期待され、半導体製造の効率性と信頼性をさらに高めることに貢献すると見られます。この進歩は、最終的に消費者にとって、より高性能で耐久性のある電子機器の提供につながるでしょう。

元記事: <https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=25328>

収集日: 2026年07月10日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#21 ヘンケル、2026年第1四半期に好調なオーガニック売上高成長1.7%を達成、接着技術部門が牽引

公開日 2026年07月07日 Henkel ドイツ



概要

ヘンケルは、2026年第1四半期にグループ全体の売上高約50億ユーロを達成し、好調なオーガニック売上高成長率1.7%を記録しました。この成長は、接着技術部門を含む両事業部門によって力強く牽引され、それぞれがプラスの販売量と価格変動に貢献しました。また、同社は3月末に10億ユーロ規模の自社株買いプログラムを完了し、株主価値向上へのコミットメントを示しました。接着技術部門の堅調な業績は、同社の多様な産業セグメントにおけるイノベーションと市場競争力を反映しています。

主要成果

ヘンケルは、2026年第1四半期において堅調な財務実績を報告し、グループ全体の売上高は約50億ユーロに達しました。特に注目すべきは、1.7%という好調なオーガニック売上高成長率であり、これは主に同社の両事業部門、特に接着技術部門によって力強く牽引されました。両部門はプラスの販売量と価格変動に貢献し、同社の成長戦略が成功していることを示唆しています。さらに、ヘンケルは3月末までに10億ユーロ規模の自社株買いプログラムを完了し、株主への還元と企業の強固な財務体質を強調しました。

技術・臨床詳細

接着技術部門は、自動車、エレクトロニクス、包装、建築など、幅広い産業分野にわたる高性能接着剤、シーラント、および機能性コーティングを提供しています。この部門の成長は、顧客のイノベーションニーズに対応する新製品の開発と、高付加価値ソリューションへの戦略的なシフトに支えられています。例えば、持続可能性に配慮した接着剤処方、電気自動車向けバッテリー接着ソリューション、高性能半導体パッケージング材料など、最先端の技術が市場に投入されています。これらの製品は、軽量化、耐久性向上、生産効率化など、顧客の特定の課題を解決し、最終製品の性能向上に貢献しています。

背景・業界文脈

グローバル経済は、不安定な投入コスト、サプライチェーンの混乱、および急速な技術変化という課題に直面していますが、ヘンケルはこのような状況下でも強固な事業基盤と戦略的な方向性を示しています。接着剤市場は、持続可能な処方への要求、電気自動車（EV）の普及、グリーンビルディングの進展、エレクトロニクスの小型化など、複数の主要なトレンドによって成長を続けています。ヘンケルは、ATP Adhesive SystemsやStahlといった企業の買収を通じて、接着技術ポートフォリオを戦略的に強化し、市場での競争力を高めてきました。今回の業績は、これらの戦略的投資と市場への適応能力が結実したものです。

今後の展望

2026年第1四半期の好調なオーガニック成長は、ヘンケルが通年の成長目標達成に向けて順調に進んでいることを示唆しています。接着技術部門の継続的な貢献は、同社の将来の成長戦略において中心的な役割を果たすでしょう。持続可能なイノベーションへの注力と高成長市場セグメントへの投資は、ヘンケルが長期的な収益性を維持し、市場でのリーダーシップを強化するための鍵となります。完了した自社株買いプログラムは、投資家への信頼を示すとともに、今後の財務的な柔軟性にも寄与するでしょう。ヘンケルは、変化する市場ニーズに対応しつつ、技術革新を通じて持続可能な価値を創造し続けることが期待されます。

元記事: <https://www.henkel.com/investors-and-analysts>

収集日: 2026年07月10日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#23 Strategic Packaging Insights、デシマブル接着剤市場が2034年までに31億2,000万ドルに成長と予測

公開日 2026年07月09日 openPR.com (Strategic Packaging Insights Inc.) アメリカ



概要

本記事はStrategic Packaging Insights Inc.が発行した市場調査レポートの概要紹介です。世界のデシマブル（分離可能）接着剤市場は、2025年の1億5,600万米ドルから2034年までに31億2,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）9.5%で成長する見込みです。この力強い成長は、包装、医療、産業用途において、持続可能でリサイクル可能、かつ高性能な接着剤技術への需要が増加していることに牽引されています。UV硬化型接着剤は、精度、迅速な硬化、環境適合性の観点から、医療および産業用途での採用が加速しています。

詳細

本記事はStrategic Packaging Insights Inc.が発行した市場調査レポートの概要紹介です。

レポート概要

このレポートは、デシマブル（分離可能）接着剤の世界市場に焦点を当て、その動向、成長要因、および将来予測を分析しています。調査対象市場は、包装、医療、産業用途など、持続可能でリサイクル可能、高性能な接着剤技術が求められる幅広い分野をカバーしています。地理的範囲はグローバルであり、主要な地域市場の成長機会を評価しています。

主要な調査結果

- 世界のデシマブル接着剤市場は、2025年の推定値1億5,600万米ドルから、2034年までに31億2,000万米ドルに達すると予測されています。
- 2026年から2034年にかけての予測期間における年平均成長率（CAGR）は9.5%と見込まれています。
- 市場の成長は、持続可能でリサイクル可能、高性能な接着剤技術への需要増加に牽引されています。
- 技術開発は、リサイクル性、クリーンリリース性能（剥離時の残渣がないこと）、接着強度に焦点を当てており、製造業者はリサイクルプロセス中に完全な分離を可能にするシステムを導入しています。
- UV硬化型接着剤は、その高い精度、迅速な硬化時間、および環境適合性の利点から、医療および産業用途での採用が著しく増加していると指摘されています。
- H.B. Fuller、Arkema、Sika、Dowなどの主要企業が、環境規制の強化に対応するため、高度な配合技術に投資していることも言及されています。

発行会社について

Strategic Packaging Insights Inc.は、パッケージング業界に特化した市場調査と戦略的インサイトを提供する企業です。同社は、持続可能性、技術革新、市場動向に関する深い専門知識を持ち、クライアントが競争優位性を確立するための情報を提供しています。

収集日: 2026年07月10日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#26 オープンPR、航空宇宙用接着剤・シーラント市場が2033年までに20億9,000万ドルに急成長と予測

公開日 2026年07月08日 openPR.com インド



概要

本記事はopenPR.comが提供する市場調査レポートの概要紹介です。世界の航空宇宙用接着剤およびシーラント市場は、2025年の12億6,000万米ドルから2033年までに20億9,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2033年にかけて年平均成長率（CAGR）6.4%で成長する見込みです。この急成長は、航空機生産の増加と、航空機軽量化および高性能接合材料への需要拡大に強く牽引されています。航空宇宙産業における技術革新と持続可能性への取り組みが、接着剤・シーラント市場をさらに活性化させると見られています。

詳細

本記事はopenPR.comが提供する市場調査レポートの概要紹介です。

レポート概要

このレポートは、航空宇宙用接着剤およびシーラントの世界市場の動向と将来予測に焦点を当てています。調査対象市場は、商用航空機、軍用機、ヘリコプター、宇宙船、およびその他の航空宇宙用途における幅広い接着および封止ソリューションを包含しています。航空機生産の増加と軽量・高性能接合材料の需要拡大を主要な成長要因として特定し、地理的範囲はグローバルにわたります。

主要な調査結果

- 世界の航空宇宙用接着剤およびシーラント市場は、2025年の推定値12億6,000万米ドルから、2033年までに20億9,000万米ドルに達すると予測されています。
- 2026年から2033年にかけての予測期間における年平均成長率（CAGR）は6.4%と見込まれています。
- 市場成長の主な推進要因は、以下の通りです。
 - **航空機生産の増加:** 世界的な航空需要の回復と新興国での航空機保有数の増加により、民間航空機および軍用機の生産台数が増加しています。
 - **軽量・高性能接合材料への需要拡大:** 燃料効率の向上と排ガス削減目標達成のため、航空機メーカーは複合材料の使用を増やしており、これに伴い、強力で軽量の接着・封止材料が不可欠となっています。
 - **航空宇宙産業における技術革新:** 先進的な材料科学と製造技術の進展が、より優れた接着性能と耐久性を持つ製品の開発を可能にしています。
- このレポートは、航空宇宙分野における厳格な安全性要件と長寿命性能の重要性も強調しています。

発行会社について

openPR.comは、企業がプレスリリースを配信するためのプラットフォームを提供するオンラインサービスです。様々な業界のニュースや市場調査レポートの概要をグローバルに広報する役割を担っています。

元記事: <https://www.openpr.com/news/4571524/aerospace-adhesive-and-sealants-market-surges-as-aircraft>

収集日: 2026年07月10日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#27 オープンPR、歯科用接着剤・シーラント市場が2030年までに104億4,000万ドルに達すると予測

公開日 2026年07月06日 openPR.com インド



概要

本記事はopenPR.comが提供する市場調査レポートの概要紹介です。世界の歯科用接着剤およびシーラント市場は、2030年までに104億4,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）10.0%で成長する見込みです。この成長は、ユニバーサル歯科用接着剤の普及、低侵襲性修復材料の需要増加、生体活性シーラントの使用拡大、および高度な接着技術の採用によって推進されています。高齢化社会の進展と口腔衛生意識の向上も、市場拡大の主要な要因です。

本記事はopenPR.comが提供する市場調査レポートの概要紹介です。

レポート概要

このレポートは、歯科用接着剤およびシーラントの世界市場に焦点を当て、業界のトレンド、成長ドライバー、および将来の展望を詳細に分析しています。調査対象市場は、接着剤、シーラント、および関連材料の様々なタイプを含み、虫歯予防、修復歯科、歯列矯正、プロテーゼなどの幅広い歯科用途をカバーしています。地理的範囲はグローバルであり、各地域の市場特性と成長機会を評価しています。

主要な調査結果

- 世界の歯科用接着剤およびシーラント市場は、2030年までに104億4,000万米ドルに達すると予測されています。
- 2026年から2030年にかけての予測期間における年平均成長率（CAGR）は10.0%と見込まれています。
- 市場成長の主な推進要因は、以下の通りです。
 - **ユニバーサル歯科用接着剤の普及:** 複数の接着プロトコルに対応し、簡便性と効率性を提供するユニバーサル接着剤の採用が拡大しています。
 - **低侵襲性修復材料の需要増加:** 歯質を最大限に保存する修復治療への関心が高まり、それに適した接着材料の需要が増加しています。
 - **生体活性シーラントの使用拡大:** 歯質の再石灰化を促進するなど、治療効果を高める生体活性成分を含むシーラントが注目されています。
 - **高度な接着技術の採用:** 接着強度、耐久性、および審美性を向上させる新しい接着技術が継続的に導入されています。
- 高齢化社会の進展に伴う歯科治療ニーズの増加と、世界的な口腔衛生意識の向上も市場拡大の主要な要因として挙げられています。

発行会社について

openPR.comは、企業がプレスリリースを配信するためのプラットフォームを提供するオンラインサービスです。様々な業界のニュースや市場調査レポートの概要をグローバルに広報する役割を担っています。

元記事: <https://www.openpr.com/news/4569570/dental-adhesives-and-sealants-market-report-examines-industry>

収集日: 2026年07月10日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#28 IDTechEx、2.5D/3D Cu-Cuハイブリッドボンディング材料など先端半導体パッケージングの未来を形作る材料を分析

公開日 2026年07月07日 IDTechEx イギリス



概要

本記事はIDTechExが発行した市場調査レポートの概要紹介です。IDTechExの最新レポートは、2.5Dおよび3D Cu-Cuハイブリッドボンディング材料、エポキシモールドディングコンパウンド（EMC）、モールドディングアンダーフィル（MUF）、そしてガラスパネルベースの先端半導体パッケージングなど、将来の先端半導体パッケージングを形作る材料に焦点を当てています。レポートでは、これらの材料における技術動向、製造プロセス、および主要な課題が分析され、業界の重要なプレーヤーに戦略的洞察を提供しています。これは、高密度集積化と性能向上を追求する半導体産業にとって不可欠な情報です。

詳細

本記事はIDTechExが発行した市場調査レポートの概要紹介です。

レポート概要

IDTechEx の最新レポートは、「Materials Shaping the Future of Advanced Semiconductor Packaging」と題され、将来の先端半導体パッケージング技術を支える主要な材料に焦点を当てています。レポートでは、2.5Dおよび3D Cu-Cuハイブリッドボンディング材料、エポキシモールドディングコンパウンド（EMC）、モールドディングアンダーフィル（MUF）といった主要材料群、およびガラスパネルベースの先進半導体パッケージングにおける技術動向、製造プロセス、および市場課題を詳細に分析しています。調査対象はグローバルであり、半導体業界の主要なイノベーションを包括的にカバーしています。

主要な調査結果

- レポートは、特に以下の先端半導体パッケージング材料に注目しています。
 - **2.5Dおよび3D Cu-Cuハイブリッドボンディング材料:** 高密度集積と高速信号伝送を可能にする、チップ間の直接銅-銅接合技術に必要な材料。
 - **エポキシモールドディングコンパウンド（EMC）:** 半導体チップを物理的損傷や環境ストレスから保護するための封止材料。
 - **モールドディングアンダーフィル（MUF）:** チップと基板間の熱膨張係数（CTE）ミスマッチによる応力を緩和し、接続信頼性を向上させる材料。
 - **ガラスパネルベースの先進半導体パッケージング:** 高い寸法安定性、優れた電気的特性、および低コストでの大型化を可能にする次世代基板技術。
- これらの材料における技術動向、製造プロセスの課題（例: 硬化時の反り、材料の適合性）、および将来的な開発方向性が深く掘り下げられています。
- レポートは、半導体性能向上のための微細化技術が限界に近づく中、先進パッケージングが次なる成長ドライバーであるという業界のコンセンサスを強調しています。

発行会社について

IDTechExは、新技術の調査とコンサルティングを専門とするグローバル企業です。同社は、エレクトロニクス、エネルギー、医療、モビリティなど、様々なハイテク産業における市場分析、技術ロードマップ、およびビジネスインサイトを提供し、クライアントの戦略的意思決定を支援しています。

元記事: <#>

収集日: 2026年07月10日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#29 オープンPR、インスタント接着剤市場が2033年までに46億2,000万ドルに成長と予測

公開日 2026年07月08日 openPR.com インド



概要

本記事はopenPR.comが提供する市場調査レポートの概要紹介です。世界のインスタント接着剤市場は、2025年の28億7,000万米ドルから2033年までに46億2,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2033年にかけて年平均成長率（CAGR）6.8%で成長する見込みです。エレクトロニクス生産の増加、電気自動車（EV）製造における用途拡大、および医療機器製造の拡大が、この市場成長の主要な推進要因とされています。迅速な接着と高い接着強度を特徴とするインスタント接着剤は、製造プロセスの効率化に貢献します。

詳細

本記事はopenPR.comが提供する市場調査レポートの概要紹介です。

レポート概要

このレポートは、インスタント接着剤の世界市場に焦点を当て、その動向、成長ドライバー、および将来予測を詳細に分析しています。調査対象市場は、シアノアクリレート系接着剤を主とするインスタント接着剤の様々なタイプを含み、エレクトロニクス、EV製造、医療機器、消費財、産業メンテナンスなど、幅広いエンドユーズ産業をカバーしています。地理的範囲はグローバルであり、主要な地域市場における成長機会と競争環境を評価しています。

主要な調査結果

- 世界のインスタント接着剤市場は、2025年の推定値28億7,000万米ドルから、2033年までに46億2,000万米ドルに達すると予測されています。
- 2026年から2033年にかけての予測期間における年平均成長率（CAGR）は6.8%と見込まれています。
- 市場成長の主な推進要因は、以下の通りです。
 - **エレクトロニクス生産の増加:** スマートフォン、ウェアラブルデバイス、IoT機器など、小型で複雑な電子部品の組み立てに迅速な接着が不可欠です。
 - **EV製造における用途拡大:** 電気自動車のバッテリーパック、モーター、センサーなどの組み立てにおいて、高い信頼性と効率が求められる接着ソリューションの需要が高まっています。
 - **医療機器製造の拡大:** 医療用ウェアラブル、診断装置、使い捨て医療品などの精密な組み立てに、生体適合性を持つインスタント接着剤が利用されています。
- 迅速な接着時間と高い接着強度は、製造プロセスの効率化と自動化を促進する上で重要な利点として強調されています。

発行会社について

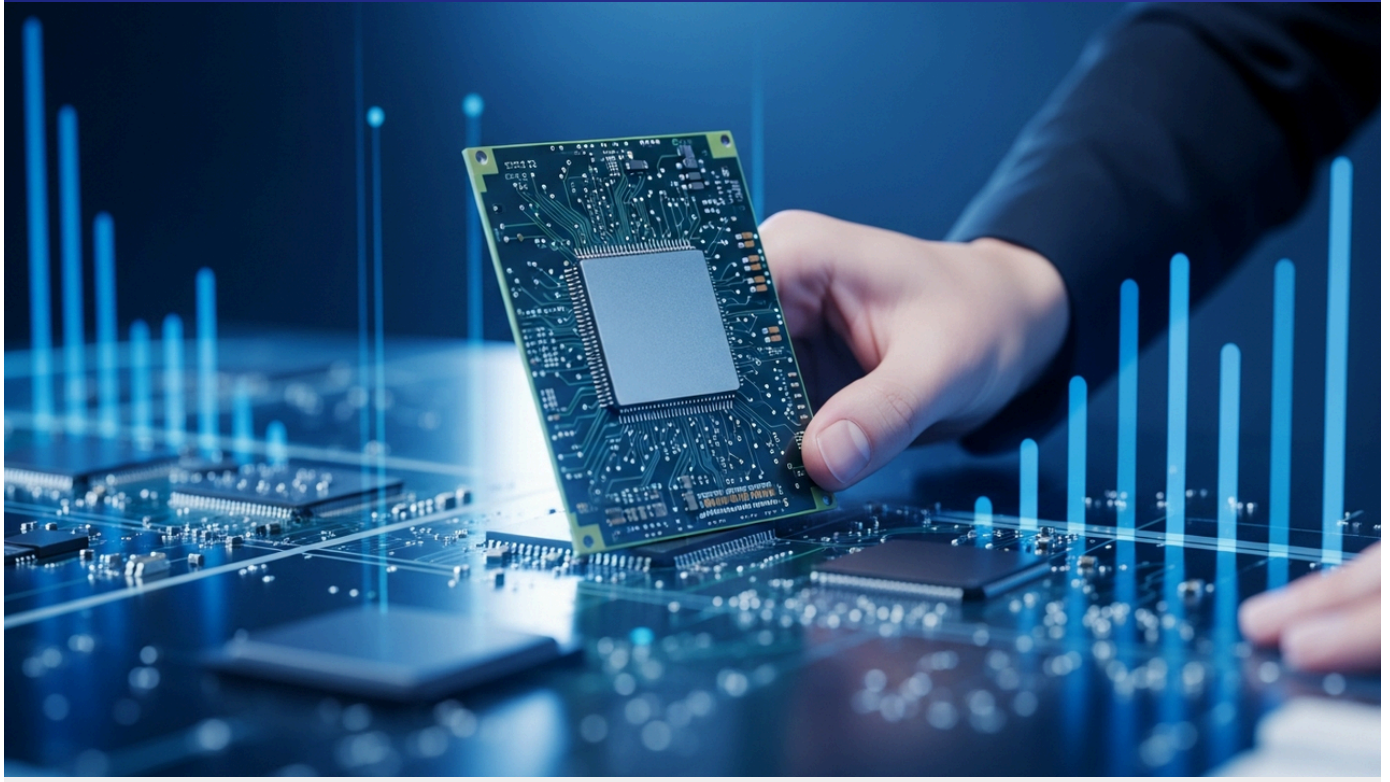
openPR.comは、企業がプレスリリースを配信するためのプラットフォームを提供するオンラインサービスです。様々な業界のニュースや市場調査レポートの概要をグローバルに広報する役割を担っています。

元記事: <https://www.openpr.com/news/4571595/instant-adhesive-market-business-outlook-2026-2033-market>

収集日: 2026年07月10日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#30 Data Insights Reports、電子回路基板アンダーフィル市場が先進半導体パッケージング需要で成長と予測

公開日 2026年07月08日 Data Insights Reports インド



概要

本記事はData Insights Reportsが提供する市場調査レポートの概要紹介です。世界の電子回路基板アンダーフィル市場は、特に自動車エレクトロニクスや高出力チップにおける先進半導体パッケージングの採用増加に牽引され、顕著な成長を遂げると予測されています。2026年初頭の研究では、熱伝導率を高め、チップと基板間の熱膨張係数（CTE）ミスマッチを低減するために、ナノフィラーをアンダーフィル配合に組み込むことに焦点が当てられました。これは、高電力密度アプリケーションにとって極めて重要であり、製造業者は80 μm 未満のバンプピッチに対応する低粘度アンダーフィル材料を開発しています。

詳細

本記事はData Insights Reportsが提供する市場調査レポートの概要紹介です。

レポート概要

このレポートは、電子回路基板アンダーフィル（Underfill）の世界市場の動向と将来予測に焦点を当てています。調査対象市場は、フリップチップ、BGA（ボールグリッドアレイ）、CSP（チップスケールパッケージ）など、先進半導体パッケージング技術におけるアンダーフィル材料の様々なタイプを包含しています。特に、自動車エレクトロニクスや高出力チップにおける採用増加が市場成長の主要な推進要因とされており、地理的範囲はグローバルです。

主要な調査結果

- 世界の電子回路基板アンダーフィル市場は、自動車エレクトロニクスや高出力チップにおける先進半導体パッケージングの採用増加に強く牽引され、顕著な成長を遂げると予測されています。
- 2026年初頭の研究開発動向として、以下の点が挙げられています。
 - **ナノフィラーの組み込み:** 熱伝導率を向上させ、チップと基板間の熱膨張係数（CTE）ミスマッチを低減するために、ナノフィラーをアンダーフィル配合に導入する研究が活発に行われています。
 - **低粘度アンダーフィル材料の開発:** 微細化が進むバンプピッチ（80 μm 未満）に対応するため、狭い隙間にも均一に充填できる低粘度アンダーフィル材料の開発が製造業者によって進められています。
- これらの技術的進展は、高電力密度アプリケーションにおいて、デバイスの信頼性と性能を維持するために不可欠であると強調されています。
- また、アンダーフィル材料は、チップと基板間の機械的ストレスを緩和し、落下衝撃や温度サイクルに対する耐久性を向上させる重要な役割を担っています。

発行会社について

Data Insights Reportsは、様々な業界セクターにわたる市場調査、データ分析、およびビジネスインサイトを提供するグローバル企業です。同社は、詳細な市場データと戦略的分析を通じて、クライアントの意思決定プロセスを支援しています。

元記事: <https://www.datainsightsreports.com/reports/global-electronic-circuit-board-underfill-material-market-22880>

収集日: 2026年07月10日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)